

【第2回】車載半導体の安定調達に向けた取り組みに関する説明会 ～車載半導体データプラットフォーム～

2026年1月14日

**日本自動車工業会
日本自動車部品工業会**

自工会・部工会事業活動にあたってのお願い

- ❑ 事業者団体の事業活動において、情報の収集・共有といった活動は場合により、**独占禁止法に抵触する可能性がある**ため、十分な注意が必要です。
- ❑ 委員会等の活動にあたっては、委員に就任した皆様は**独占禁止法**及び公正取引委員会が定めた**「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(事業者団体ガイドライン)**を遵守いただくよう、お願い致します。
- ❑ 詳しくは自工会の独占禁止法確認ページをご確認ください。

独占禁止法確認ページ

https://www.jama.or.jp/member_rule/index.html

【事例：一部抜粋】

1. (1) 価格について協議し、競争を阻害すること。
→ 業界団体の活動において、事業製品の価格に間接的にも関連するような議論や個社間の取引で協議するような費用・条件について、業界として収斂させるようなことはできない。



本日は質疑応答の時間を設けておりますが、上記独禁法をご留意の上、ご発言いただきますようお願い致します。

車載半導体の安定調達に向けた取り組みに関する説明会

目的	自工会「7つの課題」の1つである「半導体の国際競争力確保」に向け、半導体の安定調達に必要なデータを一括管理することで、半導体の生産終了に備えた準備や災害など有事における円滑なBCP対応に繋げることを目的とした業界共通のデータプラットフォームの構築に関して、説明する																										
主催	日本自動車工業会・日本自動車部品工業会の共催																										
日程	2026年1月14日(水)13:00-14:00																										
形式	ZOOMウェビナー																										
参加者	半導体を調達している部工会会員企業(調達部門の方)、サプライチェーン全体へ展開するため、会員企業の関係グループ会社も参加可能とする																										
内容	<div>自工会・部工会の半導体WGより、下記にて説明</div> <table><tr><th></th><th>議題</th><th>説明者</th><th>時間</th></tr><tr><td>1</td><td>自工会「7つの課題」と取り組みの背景</td><td>自工会 半導体WG</td><td>5分</td></tr><tr><td>2</td><td>車載半導体データプラットフォーム</td><td>自工会 半導体WG</td><td>30分</td></tr><tr><td>3</td><td>依頼事項</td><td>自工会/部工会 半導体WG</td><td>5分</td></tr><tr><td>4</td><td>質疑応答</td><td>自工会/部工会 半導体WG</td><td>20分</td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>60分</td></tr></table>				議題	説明者	時間	1	自工会「7つの課題」と取り組みの背景	自工会 半導体WG	5分	2	車載半導体データプラットフォーム	自工会 半導体WG	30分	3	依頼事項	自工会/部工会 半導体WG	5分	4	質疑応答	自工会/部工会 半導体WG	20分	計			60分
	議題	説明者	時間																								
1	自工会「7つの課題」と取り組みの背景	自工会 半導体WG	5分																								
2	車載半導体データプラットフォーム	自工会 半導体WG	30分																								
3	依頼事項	自工会/部工会 半導体WG	5分																								
4	質疑応答	自工会/部工会 半導体WG	20分																								
計			60分																								
その他	後日、アーカイブ配信を実施 ※当日説明資料もあわせて部工会ホームページへ掲載																										

本日は上記の概要で説明会を実施いたします

自工会「7つの課題」と取り組みの背景

自工会 半導体WG

■ 22年、以下の枠組みで、未来のモビリティ社会実現に向けた検討を開始

- ・経団連モビリティ委員会：自工会の活動を、関連業界のみなさまと一緒に拡大することで、モビリティ産業への進化を加速するとともに、政府との対話の窓口とする
- ・官邸モビリティ懇談会：省庁の壁を越え、総理へモビリティ産業の重要性・課題をご理解いただくことで、引き続き基幹産業として日本の競争力に貢献する

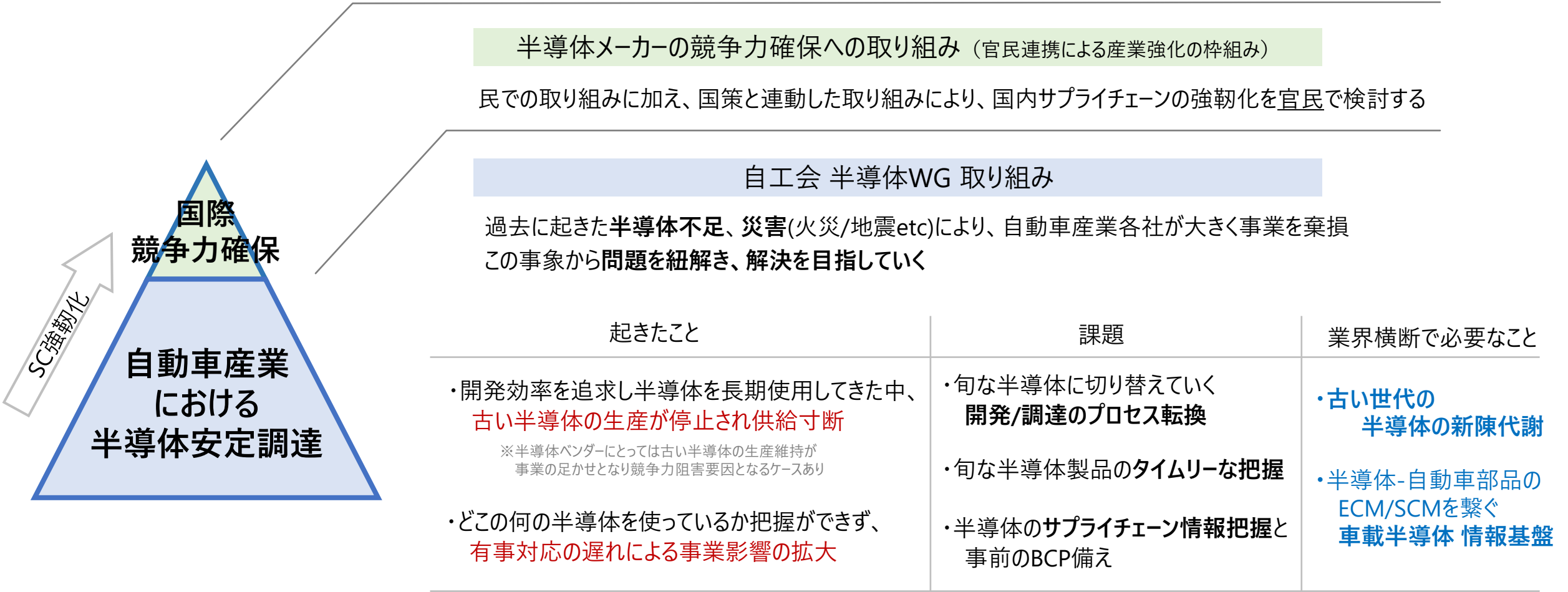
■ 23年、短期で取り組むべき優先課題として、「モビリティ産業 7つの課題」を経団連・官邸と合意

… 自工会正副会長をリーダーとし、「民間でやれること」「政府の力を借りること」を明確にしながら、トップダウンで課題に対応

課題①	片山会長（いすゞ）	物流・商用・移動の高付加価値化/効率化
課題②	内田副会長（日産）	電動車普及のための社会基盤整備
課題③	三部副会長（ホンダ）	国産電池・半導体の国際競争力確保
課題④	佐藤副会長（トヨタ）	重要資源の安定調達／強靱な供給網の構築
課題⑤		国内投資が不利にならない通商政策
課題⑥	鈴木副会長（スズキ） 日高副会長（ヤマハ）	競争力あるクリーンエネルギー
課題⑦	日高副会長（ヤマハ）	業界を跨いだデータ連携や部品トレサビの基盤構築

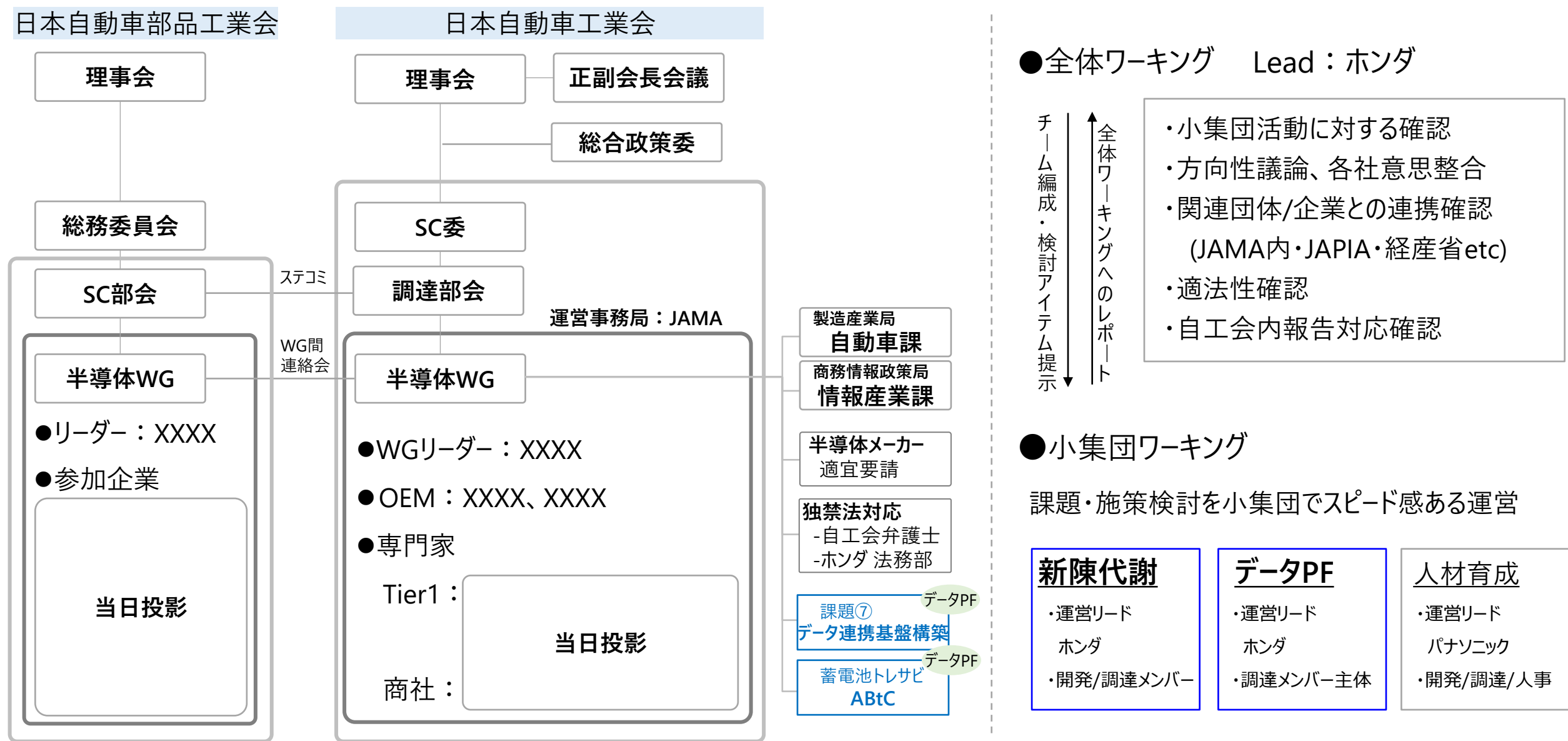
特に課題が大きい
「レガシー半導体領域の半導体の
安定調達」を取り組みと決定

環境認識 : 1. 各国をめぐる**経済安保リスク** (US半導体規制・中国低価格品流入など) 2. 自然災害や地政学リスクを受けた**BCP対応ニーズ**の高まり
ありたき姿 : 不確実な情勢の中**でも自動車産業が日本の基幹産業であり続けるために、産業のリスクを下げ、発展的な成長** (GX,DX含む) を支える環境を整備する



安定調達を成し遂げる為、業界横断で古い世代の半導体新陳代謝と半導体情報基盤に取り組んでいる

2025年度 半導体WG体制



半導体活動の広い認知と展開を目指して今期より部工会様にも半導体WGを設定いただき、連携強化中

車載半導体データプラットフォーム

自工会 半導体WG

Agenda

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 前回説明会 (8/27) 振り返り | 13:05 - 13:08 (3分) |
| 2. 車載半導体DPF 運用検討状況 | 13:08 - 13:18 (10分) |
| 3. 車載半導体DPF 開発進捗状況 | 13:18 - 13:31 (13分) |
| 4. 運営費用設定 検討状況 | 13:31 - 13:35 (4分) |

Agenda

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 前回説明会 (8/27) 振り返り | 13:05 - 13:08 (3分) |
| 2. 車載半導体DPF 運用検討状況 | 13:08 - 13:18 (10分) |
| 3. 車載半導体DPF 開発進捗状況 | 13:18 - 13:31 (13分) |
| 4. 運営費用設定 検討状況 | 13:31 - 13:35 (4分) |

課題③ 半導体安定調達 車載半導体の情報管理現状

クルマ1台に約700～1000点を搭載している半導体の情報管理イメージ (生産地・製品技術情報etc) ※最低限必要なBOM・受発注システム等は除く

現状
OEM
OEM各社がサプライヤーに半導体情報をエクセル調査・管理
～5,000点
調査という負の連鎖...
情報鮮度
管理工数
網羅性

変革のアイデア
サプライヤー
開発・調達における半導体情報管理は様々
A社 B社 C社
開発 調達
開発 調達
開発 調達
～30,000点
業務と情報管理がインテグレートされている
Excel管理 商社・EMS一任
システム持たない(持てない)為出来ることは限定的
～5,000点
このままでは、過去からの学びに対する取り組みが非効率・部分的にとどまってしまう

市中サービス
既存情報サービスは、
・民生中心(車載希薄)
・生きた情報の不足(推奨・非推奨品)
など課題があり活用は部分的

レイヤー横断の半導体データPF (協調領域の情報)

標準化やBCP対策を支える半導体の情報基盤を持つことで、業界全体のECM/SCM体質を底上げしたい

運用の悩みや、活動の温度差、レイヤー間の情報の壁がはだかり、プロセスの改革が産業全体で進まない恐れ

車載半導体データPF構想 (案)

・背景 : クライシス後、サプライチェーン安定化を目指し、OEM・Tier1が各社各様に半導体情報を集める動きが加速
・狙い : 新陳代謝促進や安定調達・BCPに必要な「情報の協調領域」を定め、データプラットフォーム化することで業界間を繋ぐ

アクセス管理
・運営費収支管理 (維持運用+サービス費)
・情報セキュリティ担保

登録促進 / 維持管理
・運営費収支管理 (維持運用費)
・情報セキュリティ担保

安定調達に必要な情報を取得 (EOLリスク低減・BCP情報)

新陳代謝促進に必要な情報を全体展開できるメリット

車載半導体データPF

情報利用者 (部品メーカー・OEM)

半導体メーカー

大分類	中分類	小分類
基本情報	製品情報	半導体型番 半導体メーカー名 半導体分類 (JEITA準拠)
	スペック	製品スペック情報 (データシート)
	ライフサイクル	SOPタイミング*1 EOLタイミング*2
レガシーリスク	仕様	プロセスノード[nm] ウェハサイズ[mm]
	生産地	前工程: メーカー名/所在地 後工程: メーカー名/所在地
地政学リスク・BCP対応	検査工程	検査工程: メーカー名/所在地
	BCP	代替有無 / 有の場合に型式
標準化	推奨リスト	推奨品フラグ 非推奨品フラグ

*1 SOP: Start Of Production / *2 EOL: End Of Life

車載半導体データが核となり、作る側(半導体)・買う側(自動車産業)を繋ぐことで、プロセス変革を広く推し進めたい
「専門家を交えた実現手法の検討の深化と加速」「参加企業の拡大」が課題

想定ユースケース

凡例: データ イベント メリット

半導体メーカー
流動品・新製品リリース時
・協調領域 各種情報
データ変更時
・推奨⇒非推奨 / PCN
・生産地等の変更
最新半導体情報
個社からの各種情報間各社
工数最小化
推奨/非推奨情報の把握による
キャリアオーバー抑制 /
新陳代謝促進

第三者運営団体
コンテンツ管理
利用者フラグ
データ主権管理
保守/運営
アクセスログ
集計
データ登録
支援ツール
(新規・更新)
【PoC対象】
共有データPF
DL
UL
(将来)自動連携
Tier1
半導体情報
No
Yes
半導体情報
有無確認

部品サプライヤー/OEM
ユースケース
① 選定・採用時
データ確認
② 供給性確認時
データ確認
③ 有事発生時
データ確認
推奨/非推奨
状況把握
供給リスクアクセス
(地政学・EOL)
クリティカル
半導体特定
有事発生時の初動迅速化
地政学リスクの対応迅速化
BOM
上記以外
自社専用
半導体情報

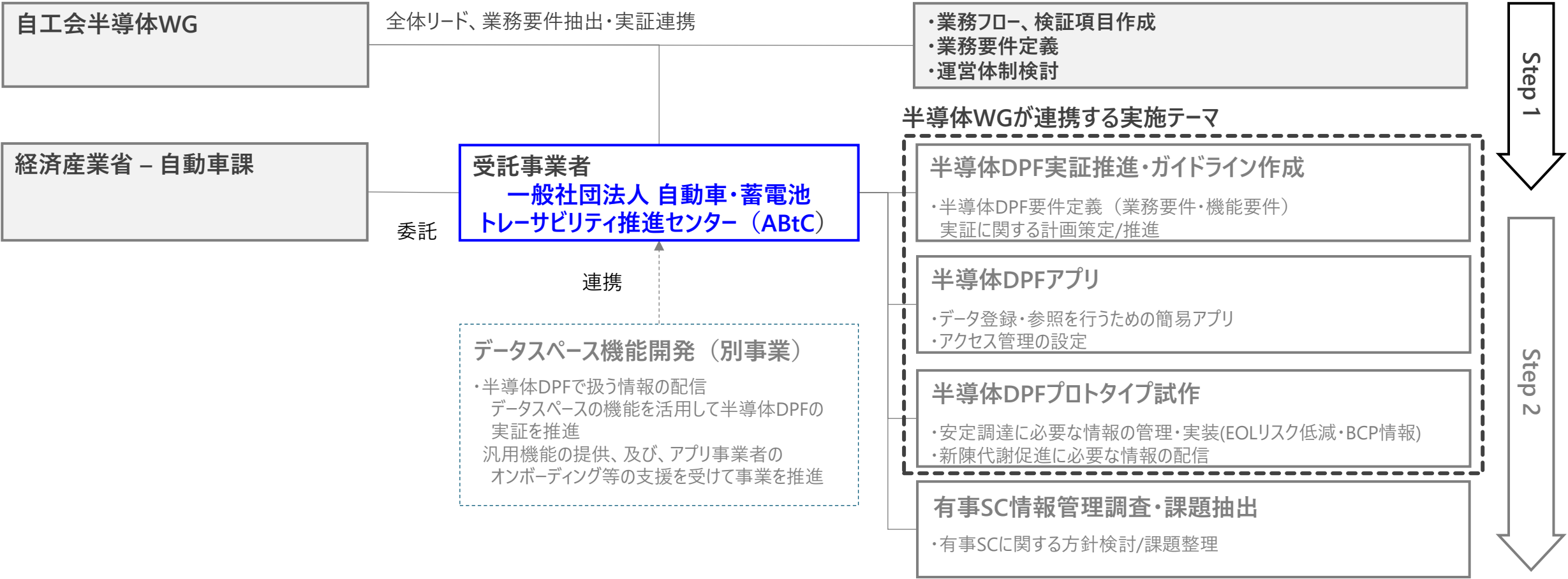
半導体メーカーとの連携状況 (全体説明会#2 対象一覧)

■半導体メーカーヒアリング対象

*参考データ: GII (グローバルインフォメーション) / 半導体産業計画総覧

車載半導体メーカー	商品カテゴリー										PoC協力				
	本社 (国)	外資系	日本法人 (都県)	日系 (都県)	アナログ	パワー	MCU	その他	車載半導体ランク*	外資系 Top10+α	日系 Top9	#1 (5月)	#2 (7月)	PoC_1 実施日	PoC_2 実施日
1 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	1	-	-	-	-	-	-
2 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	2	-	-	○	○	8/29	-
3 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	3	-	-	○	○	8/27	-
4 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	4	-	-	-	-	-	-
5 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	5	-	-	-	-	-	-
6 XXXXX	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-	1	-	○	○	8/28	-
7 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	6	-	-	-	○	9/2	-
8 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	7	-	-	-	-	-	-
9 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	8	-	-	-	(△)	TBD	-
10 XXXXX	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
11 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	○	○	10	-	-	-	○	8/28	-
12 XXXXX	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-	3	-	○	○	8/21	-
13 XXXXX	-	-	-	XXX	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
14 XXXXX	-	-	-	XXX	○	-	-	-	-	5	-	-	△	TBD	-
15 XXXXX	-	-	-	XXX	○	-	-	-	-	6	-	-	(未)	-	-
16 XXXXX	-	-	-	XXX	○	-	-	-	-	7	-	○	○	8/26	-
17 XXXXX	-	-	-	XXX	○	-	-	-	-	8	-	○	○	8/26	-
18 XXXXX	-	-	-	XXX	○	-	-	-	-	9	-	-	○	8/21	-
19 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	-
20 XXXXX	XXX	XXX	XXX	-	○	-	-	-	-	-	-	-	△	TBD	-

前回対象20社のうち17社の半導体メーカー様にご参画いただき、内9社にPoCへの協力を表明いただいた

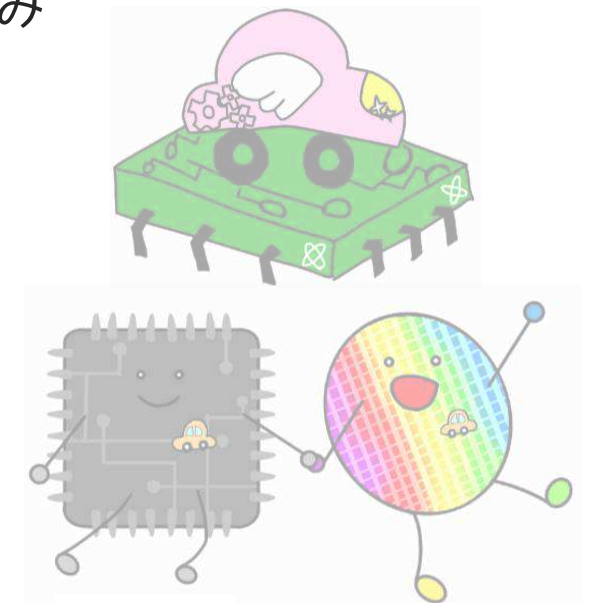


PoC主体者	実施時期	主な実施内容
PoC_1 : 自工会半導体WG	2025年8月中旬～9月初旬	・サンプルデータの選定(例.DCDCなど) ・データ登録方法の検討および所要工数の把握
PoC_2 : 受託事業者 (サポート: 自工会半導体WG)	2025年9月中旬～10月初旬	・Ouranos環境下でのDPF要件定義 ・実装に向けた実行課題および仕様改善点の洗い出し

“半導体等の自動車部品SCのデータ連携基盤構築に向けた実証事業”としてABtCが受託事業者に決定 (8/29)

車載半導体データプラットフォームの基盤サービスについて、運営を検討しているABtCより概要をご説明します。
本日はお時間も限られているので、ご質問はアンケートにご記入ください。
別途、整理してお答えさせていただきます。

1. 一社) 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC) の概要・役割・取組み
2. 半導体DPF サービス内容 | 利用のイメージ
3. 2026年度 半導体DPFサービス料金 概要(案)
4. サービス化に向けた本番運用準備会への参加のお願い



一般社団法人 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター概要

【法人名】

一般社団法人 自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター
(ABtC=「エービーシー」と略称)

【事業内容】

自動車・蓄電池のカーボンフットプリント、人権・環境デューデリジェンスに関わるトレーサビリティサービスの提供

【設立】

2024年2月14日

【所在地】

東京都港区西新橋1丁目1-1 日比谷FORT TOWER 10F

【代表理事】

藤原 輝嘉

【受賞など】

自動車・蓄電池のカーボンフットプリントおよびデューデリジェンスのデータ連携サービス関連



経済産業省「ウラノス・エコシステム・プロジェクト制度」先導プロジェクトに認定

日刊工業新聞社「第54回 日本産業技術大賞」内閣総理大臣賞

自動車LCAプラットフォームプロジェクトが「挑戦プロジェクト」として選定



公益デジタルプラットフォーム
運営事業者の認定取得
(2024年9月)



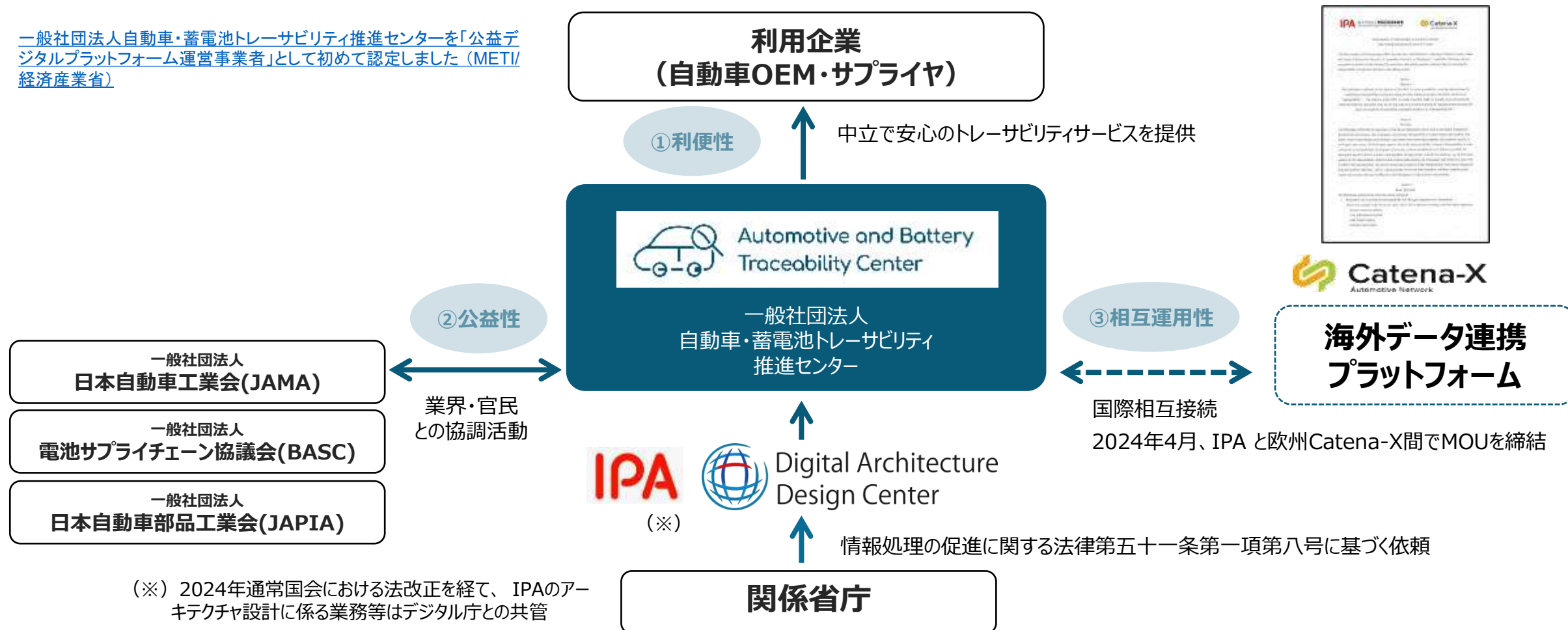
ホームページへのリンク

<https://abtc.or.jp>

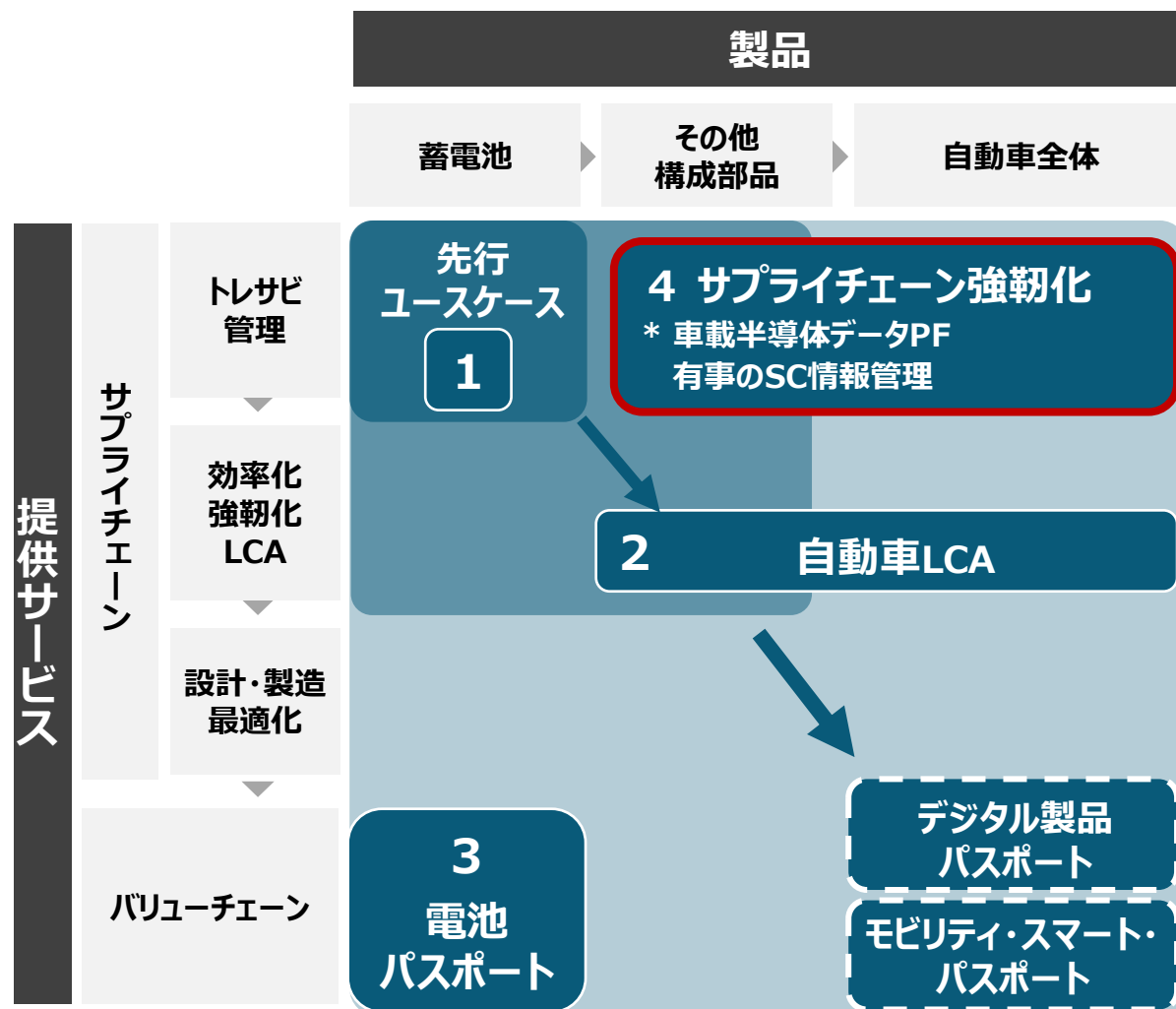
ABtCの役割について

- 2024年2月、自動車・蓄電池サプライチェーン上の企業間で安全・安心なデータ共有を実現するデータ連携システムの運営を担う事業体として、各業界団体が共同で**自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)**を設立。
- 公益デジタルプラットフォーム運営事業者**の認定を2024年9月に取得。中立公平・安全安心のトレーサビリティ基盤サービスを提供。

一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センターを「公益デジタルプラットフォーム運営事業者」として初めて認定しました（METI/経済産業省）



ABtCの取り組み計画（協調領域における公益デジタル基盤の整備）



1 蓄電池のカーボンフットプリント・デューデリジェンス

 24年5月～
本番サービス

- 欧州電池規則に対応：カーボンフットプリント条項、デューデリジェンス条項

2 自動車 1 台分のライフサイクル・アセスメント

 24年, 25年度
METI事業中

- 自動車 1 台の材料から廃棄までのライフサイクルにおける環境負荷を定量的に評価するために業界全体としてデータ連携

3 電池パスポート

 25年度
METI事業中

- 蓄電池に関するモノと情報を紐づけ、様々なサービスを創出する場を提供することで、資源循環社会の実現や新たなバリューチェーンの創造に寄与

4 サプライチェーン強靱化

 25年度
METI事業中

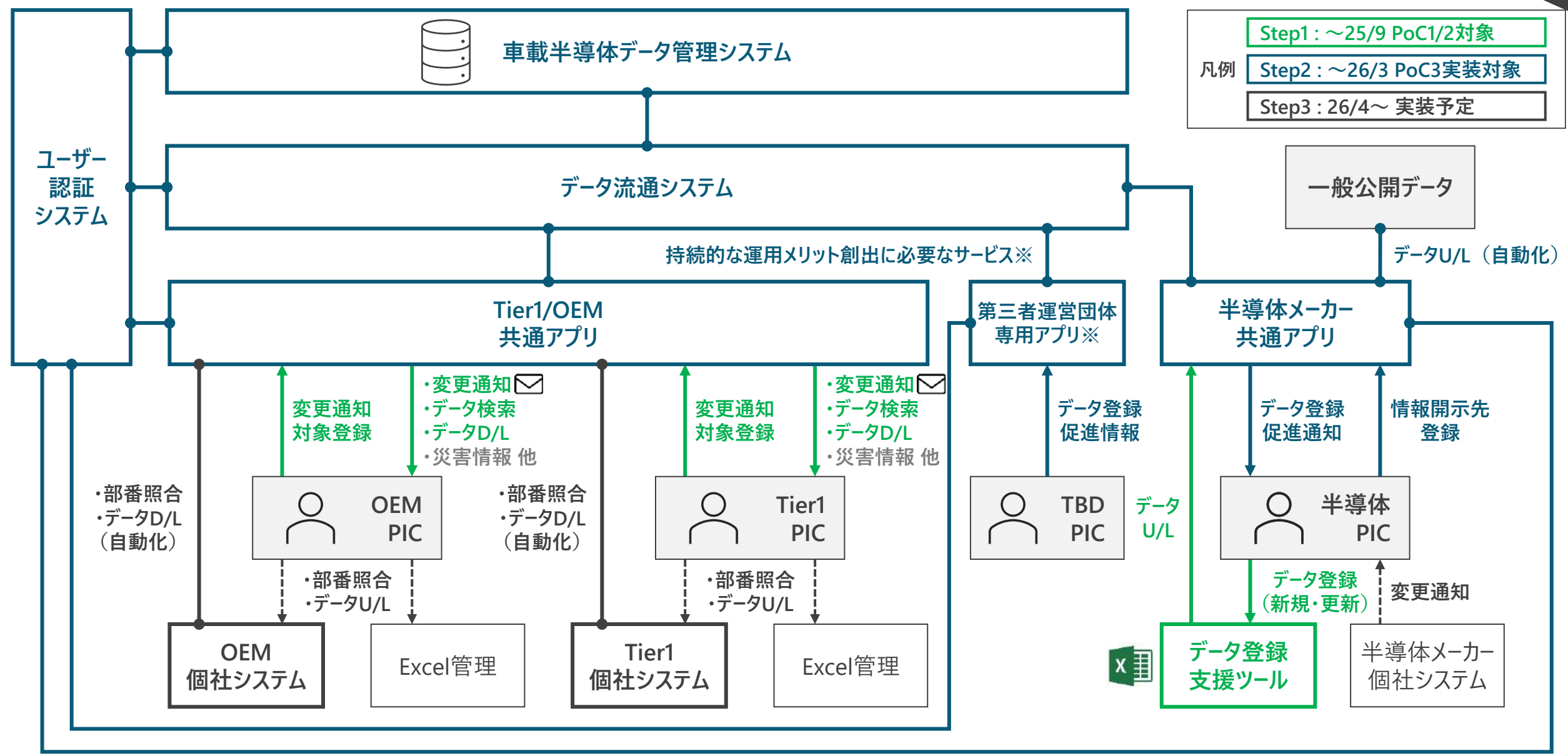
- 車載半導体データPF：**車載半導体における新陳代謝促進や安定調達・BCPIに必要な情報の協調領域を定め、データPF化で業界間を繋ぐ
- 有事のSC情報管理：**災害時の影響をサプライチェーン上の各社が連携して迅速に把握し、効率的な在庫管理・生産調整

業界横断のデータ連携基盤

- ユースケース起点でウラノス・エコシステムの基盤をシンプル・実用的に整備

Agenda

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 前回説明会 (8/27) 振り返り | 13:05 - 13:08 (3分) |
| 2. 車載半導体DPF 運用検討状況 | 13:08 - 13:18 (10分) |
| 3. 車載半導体DPF 開発進捗状況 | 13:18 - 13:31 (13分) |
| 4. 運営費用設定 検討状況 | 13:31 - 13:35 (4分) |



来春の稼働開始を目標に、FY25実装対象を”Step2”と位置づけ、車載半導体DPFの運用設計・開発を開始

車載半導体DPF 実現検討フェーズ 推進日程

■25年度 データPF 実現検討フェーズ 推進日程

対応項目		2025年 9月				10月				11月				12月					26年 1月	2月	3月	4月		
		1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29					
全体	半導体WG・DPF小集団	②#32	▽9 WG#22 ⑨#33				▽7 #23 ⑦#35					▽11 #24 ⑪#37			▽9 #25 ⑨#39					▽13 #26 ⑥#40	▽10 #27 ③#41	▽10 #28 ③#42	運用開始	
	半導体メーカー	PoC_1 (w/o ABtC) ▽▽			PoC_2 (w/ABtC)			▽			説明会#3 (11/19・20) ▽▽									PoC_3 ▽	▽	全体合同説明会 ▽	参画拡大活動 ▽	
情報提供者・利用者	OEM・Tier1 (Step1・2)	PoC協力メーカー確定 ▽	▽				PoC_1 (半導体WG) ▽	▽			参画拡大活動 (OEM→Tier1説明)						OEM向け事前説明会 ▽			合同説明会 (1/14) ▽	全体合同説明会 ▽		▽	
	OEM・Tier1 (Step3)								▽		データ利活用サービス検討						▽							
	JAPIA連携				有事BCP強化業務整理								有事BCP強化要件検討						▽		▽	有事BCP強化システム機能検討 ▽		
運営団体	半導体WG	⑤ABtC定例会#13				③#14		⑩#15			⑦#16	⑪#17		⑤#18		⑨#19				⑨#20②③#21⑥#22⑩#23⑥#24 第三者運営団体決定 ▽				会員募集 ▽
	受託事業者				▽	運営費用算出			▽				▽			ガイドライン策定					▽			
	開発ベンダー				②⑤	②	⑧	⑩	②④	③⑩	⑥	⑬	②⑩	②⑧	⑤	⑫	⑨			▽	▽	実証 ▽		
					仕様検討会 Kick off ▽					設計・開発・テスト								▽		▽				

9月中旬～10月初旬に実施したPoC_2結果を踏まえた半導体メーカー向け全体説明会の概要を本日情報共有

PoC_2結果（抜粋）

車載半導体DPF登録データ（変更案）

■車載半導体DPF登録データ一覧（変更後）

(※) ステータス：PREVIEW / ACTIVE / NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS / LAST TIME BUY / OBSOLETE

基本情報				新陳代謝促進					安定調達・BCP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
半導体メーカー	半導体型番	半導体分類	製品スペック情報	推奨・非推奨情報	プロセスノード	ウエハサイズ	SOP	EOL	代替有無情報	前工程					後工程					検査工程																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
										生産地①	生産地②	...	生産地①	生産地②	...	生産地①	生産地②	...																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
半導体メーカー名称	半導体型番 (マルチチップの場合)	半導体種別 (中分類)	半導体種別 (大分類)	データシートリンク (URL)	推奨・非推奨	製品ステータス	ウエハサイズ値	プロセスノード値	代替有無	代替半導体型番① (発注品番)	代替半導体型番② (発注品番)	原産国名①	ウエハ製造メーカー名称	ウエハサイズ値	国・地域	市町村以降の住所	州・省・県	国・地域	市町村以降の住所	州・省・県	国・地域	市町村以降の住所	検査メーカー名称	国・地域	市町村以降の住所	州・省・県	国・地域	市町村以降の住所	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述 (英語表記)	自由記述

原産国登録の廃止に加え、ウエハサイズの記載方法変更（原産国別→工程別）とマルチチップ対応（枝番管理）を反映

■車載半導体DPF登録データ別 目的・用途・記載方法

カテゴリー			平時	有事	目的・用途	記載方法
基本情報	半導体メーカー	半導体メーカー名称	○	○	データー意性の担保（KEY項目）	英語表記 ※略称可
	半導体型番	半導体型番（発注品番）	○	○	データー意性の担保（KEY項目）	基本は発注品番毎の記載とし、各Tier1・OEMによる検索性を担保
		枝番（マルチチップ専用）	○	○	マルチチップの場合の識別番号管理	特段の事由がない限り連番にて管理（「1」,「2」,・・・）
	半導体分類	半導体種別（大・中・小分類）	○	○	・検索性の向上 ・データ利活用の促進	各社の分類方法（個社分類）に準じて記載 別紙I参照
	製品スペック情報	データシートリンク	○	○	検索性の向上 ※類似品検索機能の実装判断はStep3以降	半導体型番との直接リンクが望ましいが、 検索性が担保できている場合は検索ページへのリンクで可
	推奨・非推奨情報	推奨・非推奨	○		新陳代謝ニーズの適時把握 別紙II参照	※プルダウン選択
製品ステータス		○	○	現状のステータス確認 別紙II参照	※プルダウン選択	
新陳代謝促進	プロセスノード	プロセスノード値（nm）	○		・新陳代謝促進対象選定の参考情報 ・半導体輸出管理等の該否判定	各社基準に準ずるものとする。ただし、無用な詳細情報は極力省略するという観点から、 351以上は「9999」に統一
	SOP	SOPタイミング（年）	○		・新規採用時の使用開始可能時期確認 ・EOL時の妥当性確認の参考情報	製品ステータスが「ACTIVE」の予定あるいは実績年月の「年」
		SOPタイミング（月）	○		・新規採用時の使用開始可能時期確認 ・EOL時の妥当性確認の参考情報	製品ステータスが「ACTIVE」の予定あるいは実績年月の「月」 ただし、1990～2000年以前で詳細情報がない場合は省略可
	EOL	EOLタイミング（年）	○		EOL情報の適時把握による対応手番の確保 ※将来的にはPCN対応手番の短縮	半導体メーカー希望EOL年月あるいは最短EOL年月の「年」 ※LTB(最終発注)やLTS(最終出荷)ではない
		EOLタイミング（月）	○		・EOL情報の適時把握による対応手番の確保 ※将来的にはPCN対応手番の短縮	半導体メーカー希望EOL年月あるいは最短EOL年月の「月」 ※LTB(最終発注)やLTS(最終出荷)ではない
	代替有無情報	代替有無	○	○	代替開発の迅速化	推奨代替半導体の有無 ※将来的にはAEC-Qx情報があると尚良
		代替半導体型番（発注品番）	○	○	代替開発の迅速化	該当半導体の発注品番 ※2つまで登録可

半導体メーカー毎のデータ管理運用に違いのあった「半導体分類」と「推奨・非推奨情報」の取扱いについて別途整理

■車載半導体DPF登録データ別 目的・用途・記載方法

カテゴリー			平時	有事	目的・用途	記載方法
安定調達 ・BCP	前工程	ウェハ製造メーカー名称	○	○	検索性の向上	英語表記 ※最大4つまで登録可
		ウェハサイズ値（mm）	○		・新陳代謝促進対象選定の参考情報 ・EOL時の妥当性確認の参考情報	※最大4つまで登録可
		生産地（国・地域）	○	○	・地政学的リスクのアセスメントとセンシング ・自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（必須） ※最大4つまで登録可
		生産地（州・省・県）		○	自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（必須） ※最大4つまで登録可
		生産地（市町村以降の住所）		○	自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（任意） ※最大4つまで登録可
	後工程	チップ組立メーカー名称	○	○	検索性の向上	英語表記 ※最大4つまで登録可
		生産地（国・地域）	○	○	・地政学的リスクのアセスメントとセンシング ・自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（必須） ※最大4つまで登録可
		生産地（州・省・県）		○	自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（必須） ※最大4つまで登録可
		生産地（市町村以降の住所）		○	自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（任意） ※最大4つまで登録可
	検査工程	検査メーカー名称	○	○	検索性の向上	英語表記 ※最大4つまで登録可
		生産地（国・地域）	○	○	・地政学的リスクのアセスメントとセンシング ・自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（必須） ※最大4つまで登録可
		生産地（州・省・県）		○	自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（必須） ※最大4つまで登録可
		生産地（市町村以降の住所）		○	自然災害発生時の対象半導体の早期特定	英語表記（任意） ※最大4つまで登録可

生産地情報については、各工程最大4つまで登録可能とし、市町村以降の住所は任意登録（省略可）とする

■半導体分類 記載方法詳細

	大分類	中分類	小分類
初期案 (JEITA準拠)	採用回路 (必須) 例. 電源	半導体としての機能的分類 (必須) 例. 電源用IC	用途 (必須) 例. スイッチング電源用IC
変更案 (PoC結果反映)	半導体としての機能的分類 (必須) 例. 電源用IC	用途 (必須) 例. スイッチング電源用IC	詳細用途 (任意) 例. 降圧・昇圧

見直し ポイント	<div>・大分類の「採用回路」はTier1の使い方次第であり、用途が一意に定まらないことから記入不要とする</div> <div>・小分類の位置づけとして詳細用途があると検索や選定のしやすさに繋がるため任意登録（省略可）とする</div> <div>※来春リリースに向けては、標準分類ではなく各社の個社分類による登録とするが、将来的には標準分類と個社分類の読み替えテーブルを構築予定</div>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■推奨・非推奨情報 用途詳細

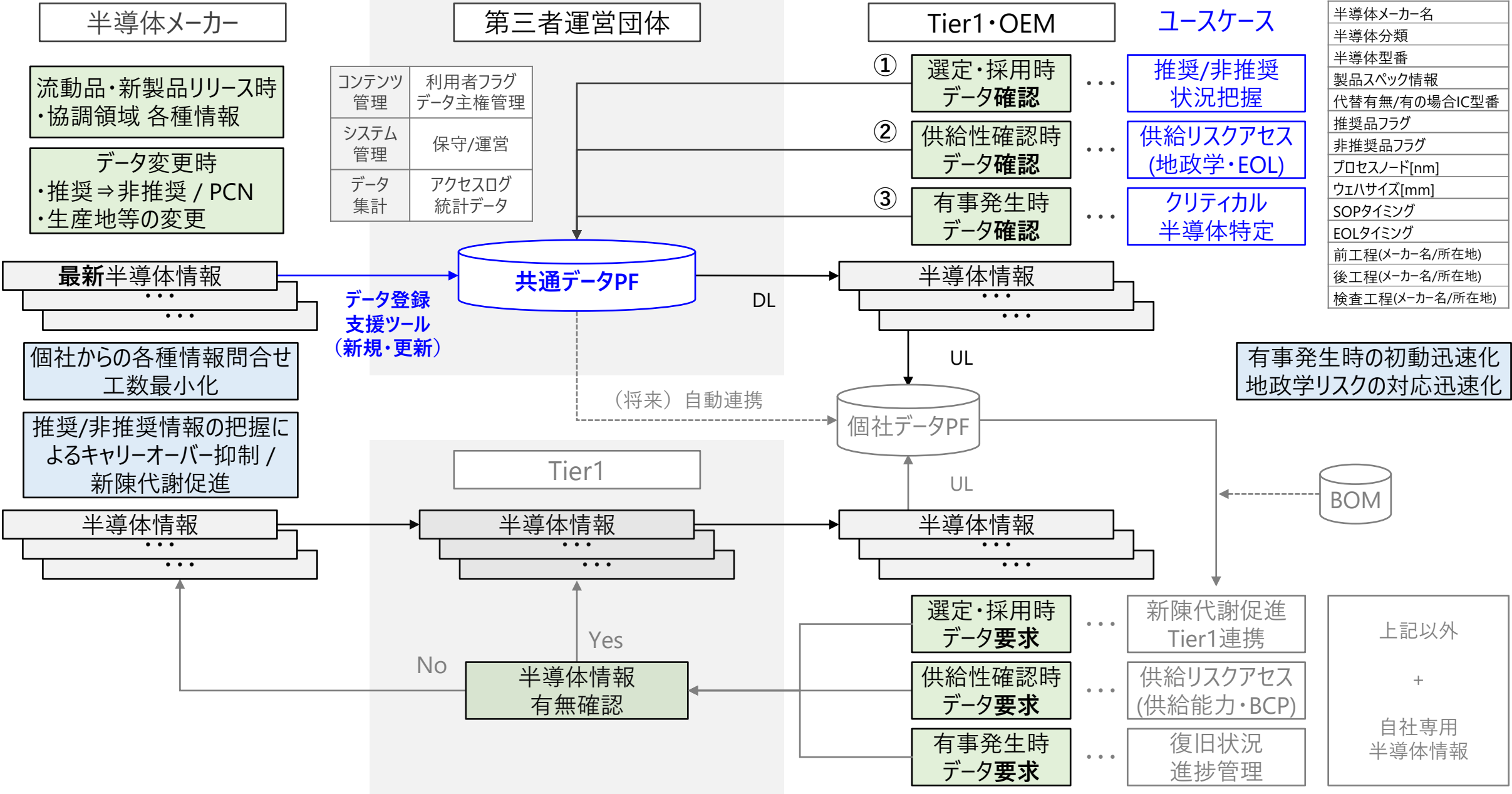
	製品ステータス	新規	量産中
RECOMMENDED (推奨)	PREVIEW (開発中)	採用	-
	ACTIVE (生産中)	採用	継続使用
NOT RECOMMENDED (非推奨)	NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS (新規採用禁止)	採用禁止	供給性確認
	LAST TIME BUY (最終オーダー)	採用禁止	対応方法確認 (代替 or 残置)
	OBSOLETE (生産終了)	採用禁止	-

情報利用者側の目的・用途の明確化によりデータ登録・更新工数の適正化を図りつつ、更新頻度は基本3カ月を想定

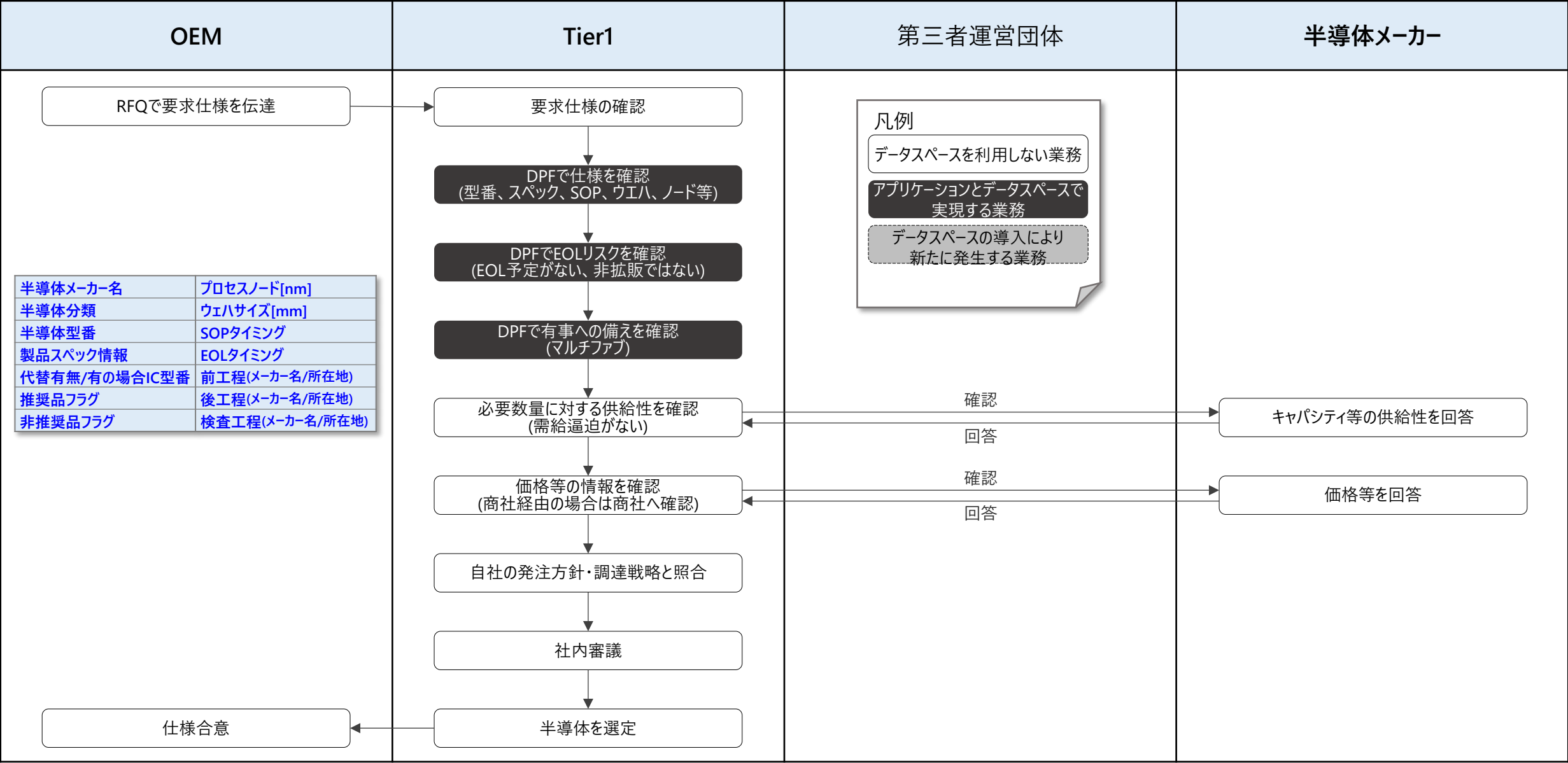
運用検討状況

協調領域

競争領域

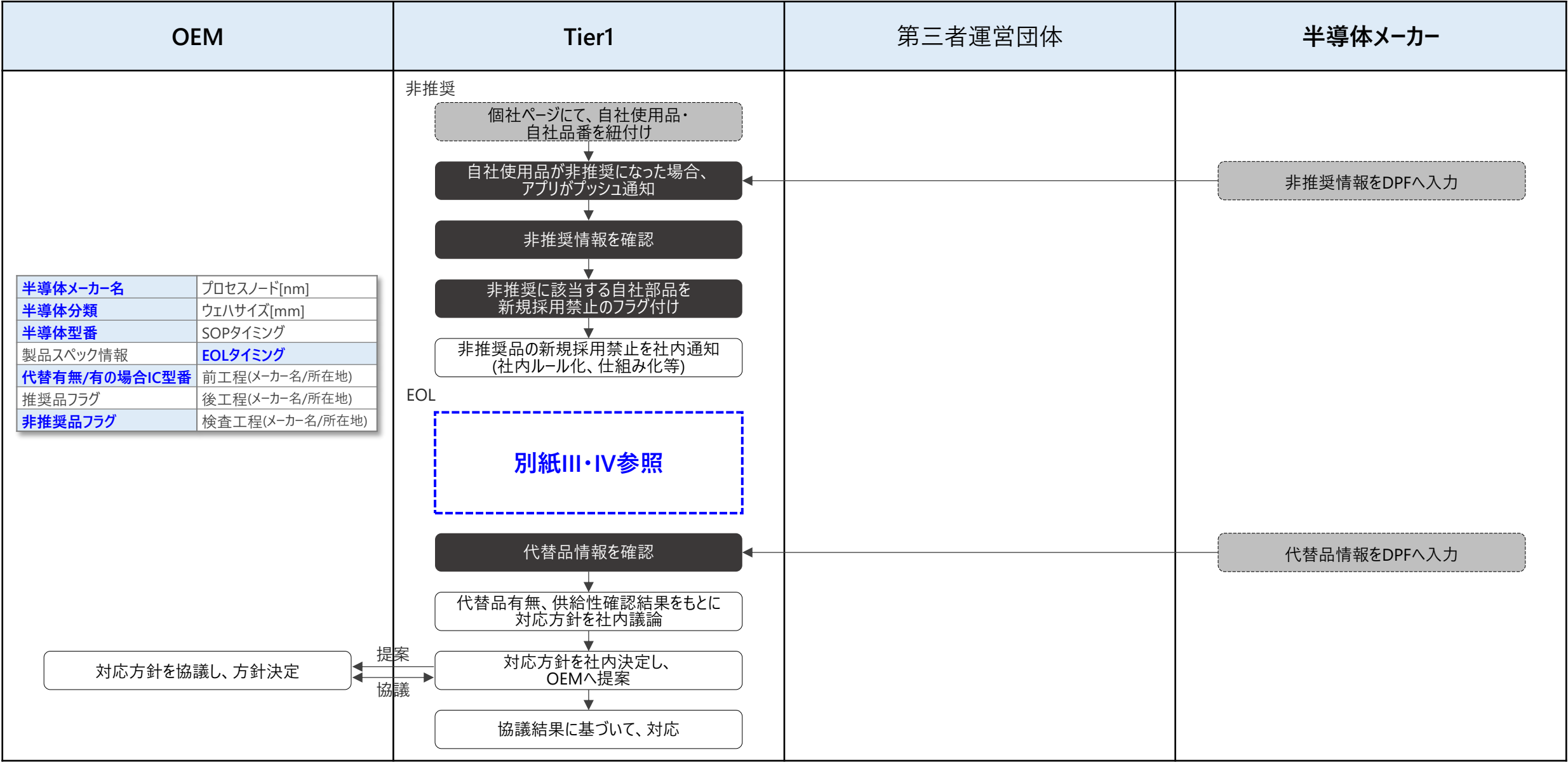


業務フロー（①選定・採用時）

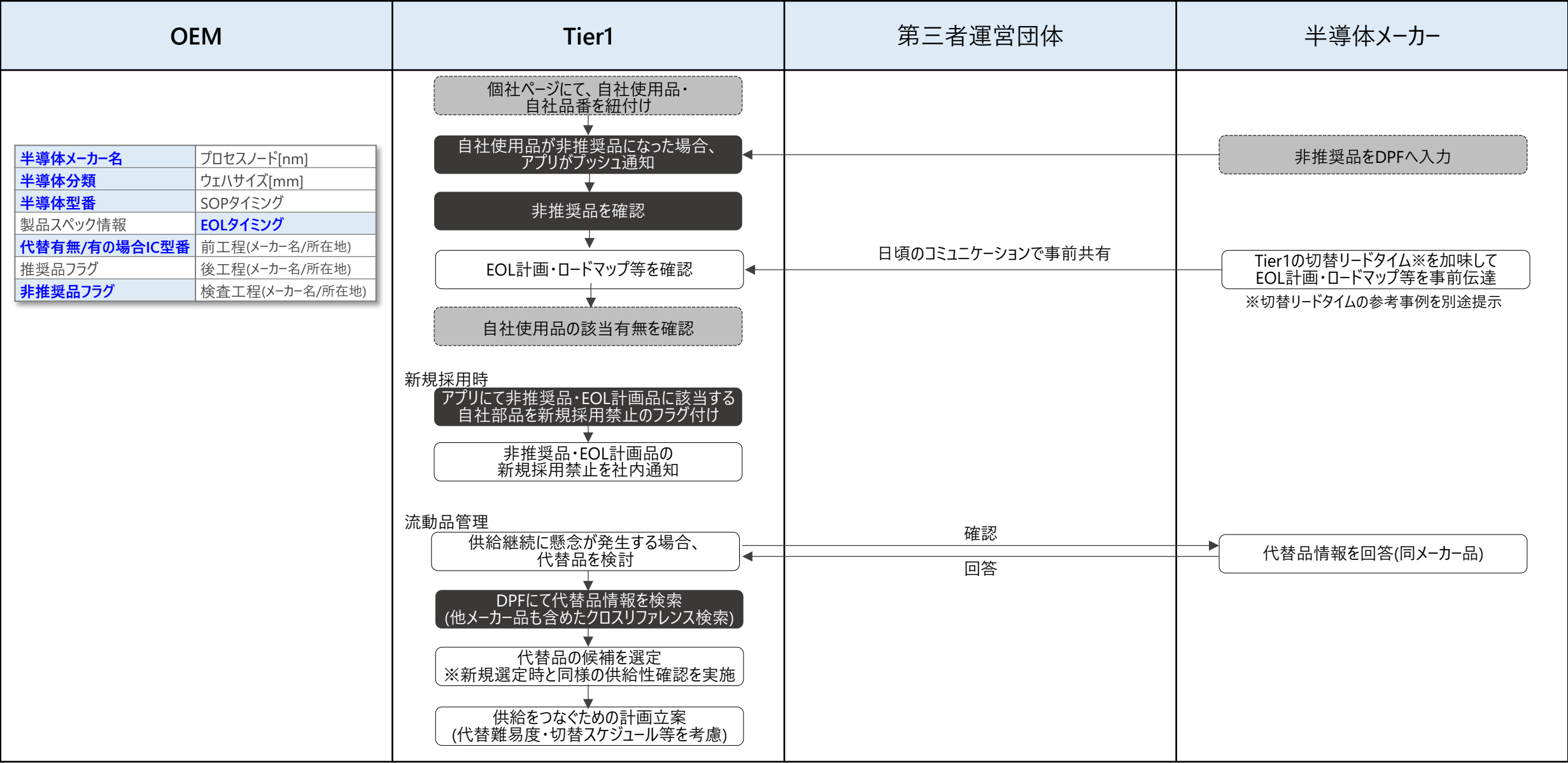


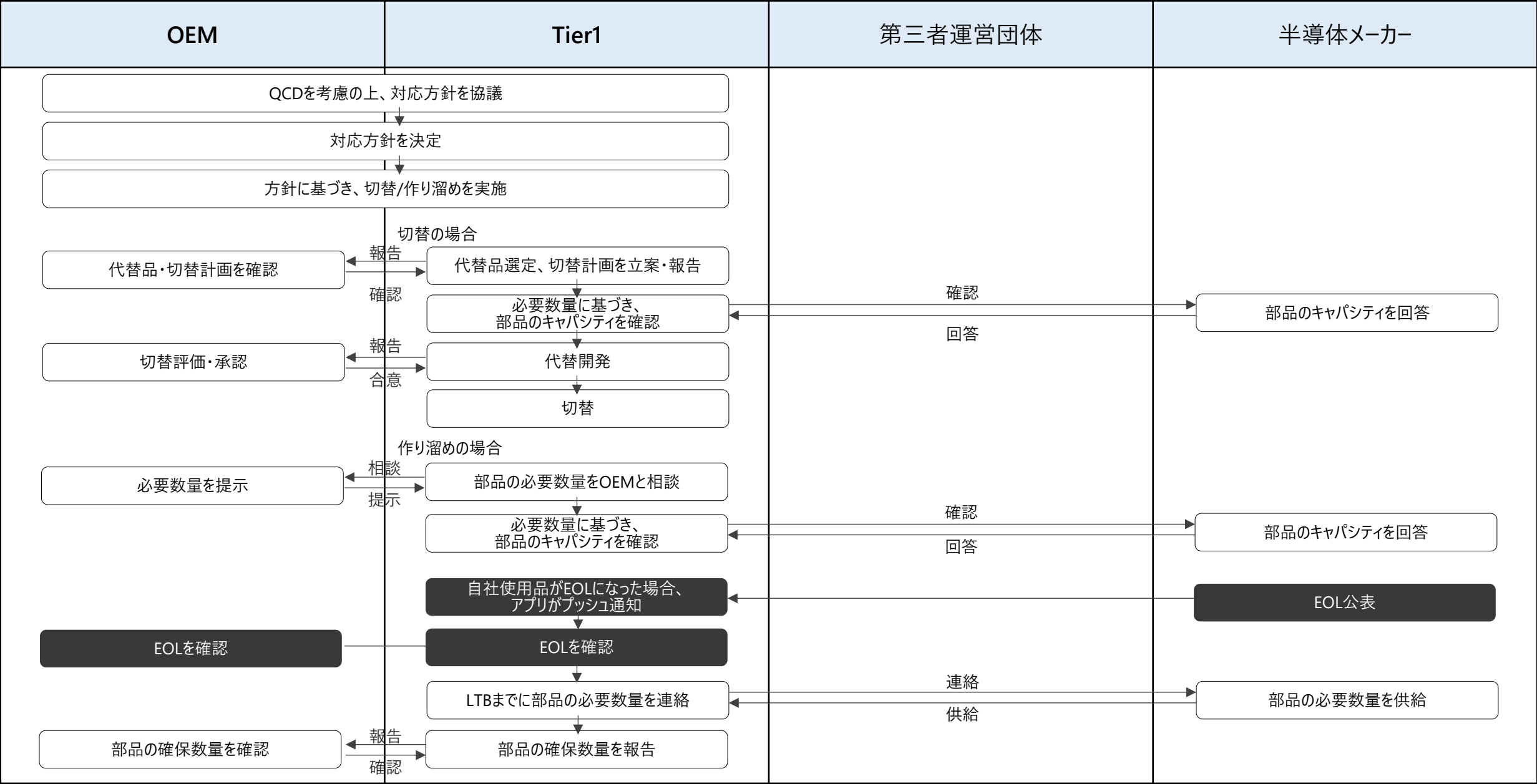
OEMにて新規選定する場合についても、業務要件は上記Tier1フローと同一と想定

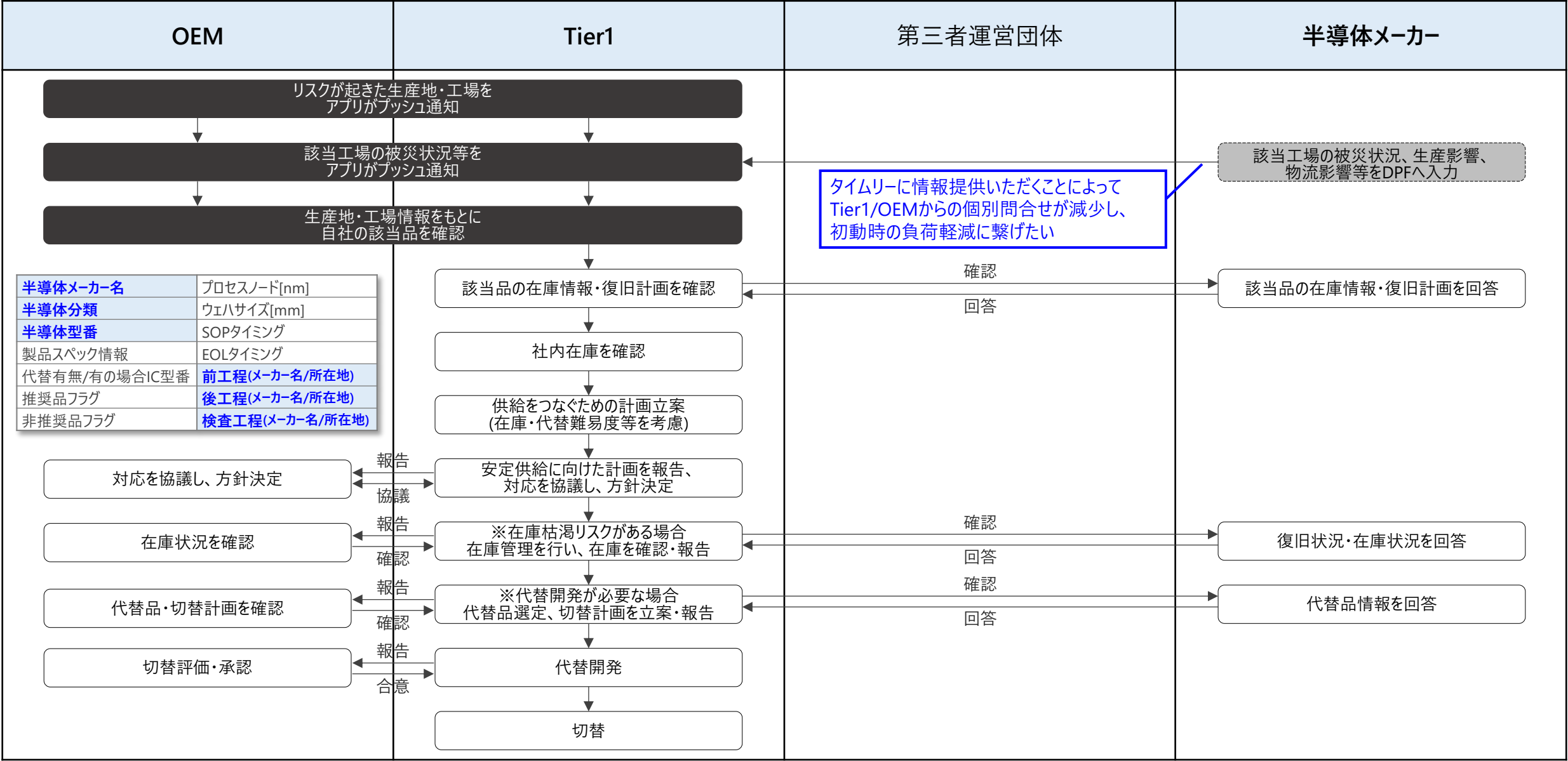
業務フロー（②供給性確認時）



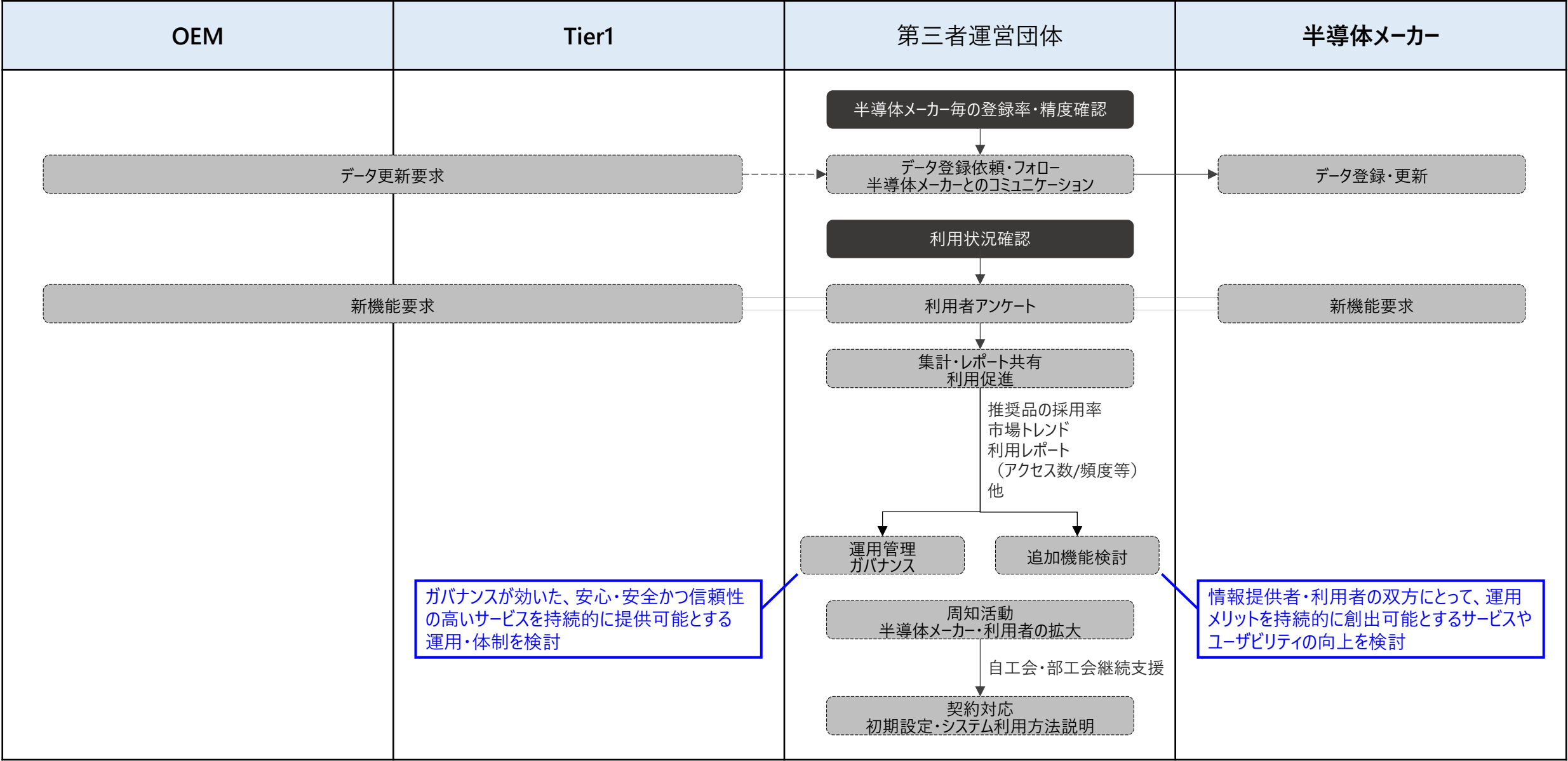
変更通知の対象ICについては、各OEM・Tier1にて使用IC情報を登録することが前提







地政学的リスク・自然災害リスクに対するBCP対応については、有事発生時の発動条件の設定が課題

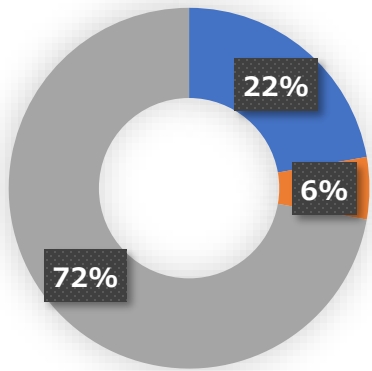


アンケート結果



11/19.20開催「全体説明会#3」アンケート - 半導体メーカー様向け (1/4)

Q1. 運用メリット（新陳代謝促進・個別対応工数削減）は得られるか？（左記質問で可以外の場合）理由/要望 等

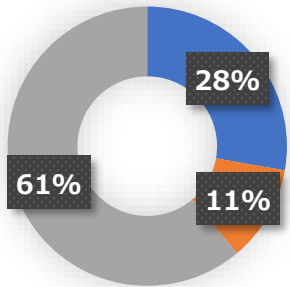


■ 可/OK ■ 不可/NG ■ どちらとも言えない/Neither

- 運用メリット（新陳代謝促進・個別対応工数削減）になるかまだイメージわからない。結局最後は個別で依頼されるのではないかな？
- 新陳代謝促進に関しては一定の効果が期待できそうですが、データメンテに関しては追加工数になるものと懸念しているため。
- 各社が現在、独自のデータベースで運用している状況を踏まえると、参画企業すべてが短期間で垂直立ち上げ的に本システムへ移行できるとは考えにくい。
- 現時点では半導体メーカーは情報提供のみ（個別対応工数増）で本運営によるメリットが見えません。
- システムへのデータ入力、データメンテナンスに伴う、人件費や工数は相応の負担となる。
- 同PFでの運用スキームを構築頂き、レガシー半導体の新陳代謝が進む事を期待します。また合わせて、PCN承認などの工数削減につながる事も重要と考えます。
- 本データPFを用いた具体的な運用を確認させて頂いた後、正式にご回答予定です。
- 製品の汎用性にも依存すると思うし、追加で掛かる工数も出てくると考えておりますので、まだどちらともいえないのではないかと考えております。
- メリット、デメリットの検討において不明点が残っているため。（悪用できたり、工数が増えたり、お金が発生したり、新陳代謝促進を産まなかったりなど）個別議論の場を設定させてください。
- 新陳代謝の手間が削減する具体的な事例をいくつかピックアップしておきたい（個別問合せが減る、このPF上でのステータス変更でEOLできるなど）Tier1など利用者側にもルールを作り、このDPF上で確認できるデータの問合せは禁止等しないと個別問合せが減るイメージがわからない。
- 費用対効果（半導体メーカー視点）の見える化活動進捗状況について伺いたい。
- メリットの有無は費用、定期メンテ工数も踏まえて総合判断判断と考えております。
- Operational benefits are still unmeasurable as Data platform is not a promotion tool of supplier rather it is designed for CAR OEM/TIER1 companies to consider new part. if all CAR OEM or TIER1 consider the part based on this DP as a golden source in the entire industry, then it could be beneficial information repository
- 新陳代謝促進については、Tier 1 / OEM の設計部門、量産部門、購買部門の末端まで本データPFの趣旨が徹底され、運用されるかどうかにかかっていると考えます。半導体メーカーにとっての個別工数削減についても同様ですが、本データPFと個社への説明の二重の工数がかかる事を懸念しています。
- 個々の会社が持つテクノロジーは様々な為、プロセスノードが新陳代謝の判断基準として一律適用できないところはありますが、ある程度の目安になると考えます。工数削減については、Data入力項目が不明であることとメインテナンスが求められることより、工数削減は見込めないと考えます。
- 新陳代謝促進は可能かと思いますが、OEM様 Tier1様がどのようにデータを使用されるかが不透明です。また本DPFの参加及びデータ提出にて工数が増えております。このDPFを使用して 既存の工数がどの程度削減できるかが理解出来ておりません。

（左記質問で可以外の場合）理由/要望 等

- 現時点では判断が難しいです。今後、具体的にどのようなシステム仕様で運用していくのか理解が必要です。
- ご提供が必要となる情報の内容次第では不可となる場合がございます。
- データ主権に基づく情報の開示先の設定 = 主権の規則という認識で正しければ基本的に問題ないと思いますが、正式には最終説明会後に判断とさせていただきます。
- 専門家の確認までは間に合わなかった為、別途確認を実施します。考えられる法令順守、ケア・対応が必要と思われるもの
- 不正競争防止法、独占禁止法・機密保持やアクセス制御（暗号化、権限管理）
- アルゴリズムの透明性や利用目的の明示義務（マーケティングや第三者提供に使われる懸念）
- 免責事項の明示・サイバーセキュリティ関連の対応、構え
- 現時点で特定の必要事項は判明しておりませんが、十分に必要事項の確認ができていないため。
- プロセスノードについては、BCP上重要な指標になるのはSoC、AIチップ、MCU、メモリ製品等であり、大部分のパワー半導体やセンサー製品についてはプロセスノードの記載がかえって参照される方の誤解を招く危険があると考えます。BCP観点上記記載が必要な製品と不要な製品を分けてガイドラインを作成し、関係者が共有すべきかと思ひます。データ主権者の判断ではなくデータPFのガイドラインとして明示していただけると有難いです。
- 開示先を設定できることより可と考えます。現在は特別に必要とされる対応は無いと考えますが、将来的にも同様化は不明です。
- 半導体製品のステータスについてはお取引のあるお客様のみ提供しておりますため、今回のデータベースへの弊社製品ステータスの提供について弊社内法務と確認が必要。

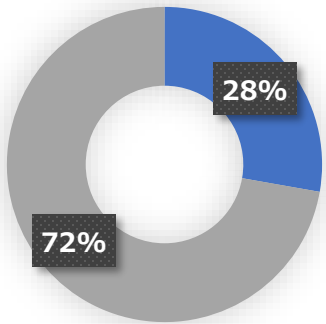


■ 可/OK ■ 不可/NG ■ どちらとも言えない/Neither



11/19.20開催「全体説明会#3」アンケート - 半導体メーカー様向け (2/4)

Q3.車載半導体データプラットフォーム構想に参画いただけるか？ (2026年サービス開始時に利用)



■ 可/OK ■ 不可/NG ■ 要検討/Under Consideration

(左記質問で可以外の場合) 理由/要望 等

- ・(もし費用が発生する+入力工数がかかるなら) 上層部への報告 & 承認が必要
- ・費用面が発生する場合、その点については社内でアラインされていないため
- ・参画に伴う費用負担が発生するため、投資に見合う効果(業務効率化やビジネスメリット)がどの程度期待できるかを精査する必要があります。
- ・費用・データ登録や定期メンテナンスに伴う工数などの総合的な情報をもとに判断させていただきたく、お願い致します。
- ・半導体メーカーとして現在無償でPoC活動に協力させて頂いております。本サービスに参画判断するにあたり、受益者負担という観点も踏まえ、費用負担をクリアにさせていただくことをお願い致します。また参画の場合も、製品事業部により、対応できる粒度、時期に差が出る可能性があります。
- ・運用面・費用面でより具体的な情報を頂いた後に社内検討の上、正式回答とさせていただきます
- ・社内にて、対応方法等々含め、検討させて頂きます。
- ・説明会など参加したメンバーとしては、基本的には参画方向で検討はしているものの、運用メリットの理由部分にも記載した内容の通り、**半導体サプライヤー側の恩恵がまだ見えにくく、参画に対して弊社内での参画合意を取れるかどうか不透明**である、と感じているためです。本活動はOEM/Tier1/半導体サプライヤーを含めたサプライチェーン全体の重要な活動という認識もあり 社内合意に向けては上層部とも整合を取っておきたいと考えています。 従って、2026年サービス開始時に向けては、本アンケート含め、これまでに挙がってきている内容の潰し込み、もしくは予定や見通しなどの明確化をお願い申し上げます。特に運用メリット部分についての補強ができますと幸いです。
- ・費用、定期メンテ工数も踏まえて総合判断判断と考えております。**メリットを運用前に具体的に実感することが難しく可否判断しかねている状況**です。
- ・From technical side, most of information are available in our website, therefore if certain connectivity such as API could to retrieve our information, then it could be one option to be on the DP, however we need to consider carefully as we don't know sure exactly how CAR OEM/ TIER1 to consider the part based on this DP. Will need to monitor the progress of this project
- ・現時点では参加の方向で社内調整を進めております。最終的には情報提供する項目について社内の合意を取った上で判断する事になると思います。
- ・参画したいと考えます。しかしながら入力が必要とされるアイテムが不明なため、負荷が測りたいところがございます。製品カテゴリ別に入力必要な項目を確認させて頂きたく考えます。参画するに辺り、サプライヤーとしては負荷が増える為、会費が発生する場合は協議が必要かと考えます。
- ・参加費用が発生する場合、社内関係部署から承認を取得しなければならず、現時点で明確な回答が出来ない状況です。
- ・半導体製品のステータスについてはお取引のあるお客様のみ提供しておりますため、今回のデータベースへの弊社製品ステータスの提供について弊社内法務と確認が必要。

Q4.情報開示先管理はどの形式を希望するか？



■ ホワイトリスト形式/Whitelist Approach
■ ブラックリスト形式/Blacklist Approach

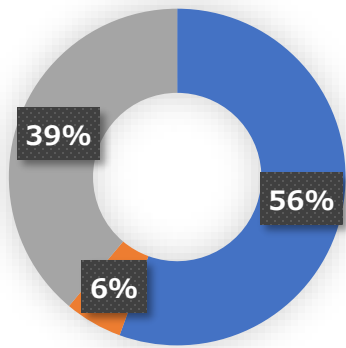
(左記質問に対する) 理由/要望 等

- ・あくまで個人の感覚。開示先を決めた方が安全な気がする
- ・データ利用事業者が追加された際の確認がしやすい
- ・競合以外に非開示対象御座いません
- ・追加される場合に、都度開示/非開示を設定したいため。
- ・**ブラックリスト形式では対応が困難になるため、ホワイト形式を希望**します。
- ・仮に作業者での入力漏れが生じたとしても開示されない方が望ましいため。
- ・1顧客のみ専用のカスタムチックな製品の場合を想定すると、全製品に対する開示先のフィルタに加え、製品ごとにフィルタ出来るような機能があるほうが望ましいと考えます。 個別の設定で煩雑になることも予想されますが、デフォルトは一括でのホワイトリストでの判別、 特別な製品においては一括設定とは別に個別でのフィルタリングができると有難いと思います。
- ・登録製品毎のデータ利用事業者の選定となるか？(セミカスタム製品の場合、開示先を限定できるか？)
- ・どの企業が対象企業になるのか現時点では網羅的に理解できないので、都度開示判断ができるホワイトリスト形式を希望・よくわからない。
- ・it is too soon to decide which option could be the best, at this moment, default setting (whitelist) is okay
- ・内製半導体部隊を有するTier 1 様の当該部隊への情報漏洩無きよう徹底していただきたいと存じます。
- ・表示先を常に確認できる為、ホワイトリスト形式が良いと考えます。
- ・NDAの観点から、個別NDAが必要となった場合ホワイトリスト形式でのみ対応可能



11/19.20開催「全体説明会#3」アンケート - 半導体メーカー様向け (3/4)

Q5.PoC3（2026/1月中旬から2026/2月中旬実施）活動に個別に協力いただけるかどうか？



■ 可/OK ■ 不可/NG ■ 要検討/Under Consideration

（左記質問で可以外の場合）理由/要望 等

- ・（もし費用が発生する＋入力工数がかかるなら）上層部への報告＆承認が必要
- ・データ登録や定期メンテナンスに伴う工数などの総合的な情報をもとに判断させていただきたく、お願い致します。
- ・PoC3も引き続き協力させて頂く方針ですが、1か月(1月中旬から2月中旬)と限られた期間でといった内容を想定されているか、早めの情報開示を希望します。
- ・事前手続きなど確認の後、正式判断とさせていただきます。
- ・**大変申し訳ございませんが、工数が確保できないため、辞退**させていただきます。
- ・実装開始後の参画(26年6月～9月諸手続き)となる場合、PoC3や実装時点からの参画と比較して 半導体メーカー側にデメリットや不利益はありますでしょうか。
- ・基本使用料が確定する時期はいつでしょうか。
- ・Mentioned in earlier, need to monitor for a while how CAR OEM / TIER1 use this DP as a solid process for selecting the part from each supplier, as an industry standard, it is too soon to decide to be on this DP or not
- ・負荷の重さを把握したく考えます。しかしながら、POCに参加しないと詳細が判りかねる為、参加の必要性は有と考えます。
- ・引き続き AB t C社様に弊社Format⇒DPFのFormatへの変換作業をPoC3でもお願い致します。
- ・何れ参加と思われる為、どこかのタイミングで参加を検討。



11/19.20開催「全体説明会#3」アンケート - 半導体メーカー様向け (4/4)

Q6.11/19.20開催「全体説明会#3」に対するご意見・ご感想

- ・概ね運用のイメージが把握できました。
- ・費用負担については早期に明示をお願いします。運用メリット面の確認の意味で、できれば無料試用期間などを設けて頂ければ幸いです。要望事項の実施可否についても確認をお願いします。
- ・運用開始に向けて、準備が進んでいると感じました。引き続き、よろしくお願い致します。
- ・効果金額の試算（個社申請がなくなる）など、は当方試算のみになるでしょうか？試算するにしても情報の不足があると考えております。ご検討をお願いします。
- ・DPFは英語表記統一とのことだが、当方のリンクや情報（マクロ転記）が日本語の場合、英語に変換する工数が発生するか？
- ・前回同様、打合せ時間がおおししまい、質疑による理解の深堀ができませんでした。活発な意見交換、質疑応答によりメリットを見出していきたいです。別途個別打合せの場を設定させてください。
- ・登録された情報がいつ開示されるか、当方の製品ステータス 改定時と同期されるのかなど方法論（時期によっては採用控えの発生、またはその逆）が不明ですが、あと1回のPoCを経て運用にこぎつけれるイメージがなく、不安が大きいのが率直な感想です。
- ・GaNなど外部から調達してマルチチップ化する場合、情報が自社以外になるが、情報として生産地等必要でしょうか？
- ・データのバックアップや履歴等、運用側でも管理をして欲しい。
- ・エクセルに記入する時、メーカーAと記載するべき所を誤ってメーカーBとしてリストをUPLした場合、マスターデータが壊れないか等、運用時を想定したデバックが必要と感じた。
- ・前回アンケートで意見した内容について回答が欲しい。
- ・新規設計非推奨からラストタイムバイにステータスを変更する時のルール決めが必要と感じた。ルールを守れば比較的容易に品番収束にもっていけるのであれば、部品メーカーとして新陳代謝が進み、大きなメリットになる。
- ・今後、来春の運用開始後についても、継続的にシステムの改善していくような体制を希望します。まずは現状でスタートすることも賛同してはおりますが、しかしながら最終的には本来の目的を完達したいと考えており、そのためにも現状および今後も積み残し課題を1つずつクリアしていく必要があると考えます。継続的に運用後も改善をさせていただきたいと思います。半導体サプライ側で協力できることは我々も継続して対応して参りたいと考えています。
- ・DPF活用に対するルールやガイドラインの制定の検討をお願いします。DPFを利用することに対して、サプライチェーンの全3者がメリットを享受できるような制約を掛けないと、本格的な活用が進まないと思います。
- ・DPF活用に関するKPI、効果のモニタ、振り返りの時期とアクションの設定が必要ではないかと思ひます。ご検討宜しくお願い致します。
- ・半導体分類の一覧表を開示していただきたく存じます。
- ・プロセスノード値について、各社の定義ばらばらでまずはスタートするとのことでしたが、有事の際や活用のユースケースにおいては、DPFで層別したのち、結局はノードに関する問い合わせが個別に来ることが想定されます。最終的には各社基準の統一、もしくは変換が必要と考えます。

- ・推奨区分については、各社基準ではなく、共有いただいた資料内の表に従う形になるのでしょうか？
- ・2日目の質疑において、EOLした製品もDPFに残り続ける（データの削除は基本的にない、というコメントからの連想）と理解しましたが、EOL後はデータ削減や半導体サプライ側の管理面の理由などから一定期間に削除したほうが良いのでは？と考えます。逆に残す意図
- ・目的があるのであれば教えていただきたく存じます。
- ・運用費用に関して、データ利用料をもしサプライ側が利用料を払えば見えるのでしょうか？（恐らくそうではないと想定してはいます） 確認の背景としては、データ提供者は総じて見えなくする制約を掛けないと悪用される懸念があります。提供者と閲覧者の線引きや、誰が利用で誰が提供者なのか？は何か公に開示する予定でしょうか？ 懸念事項として、OEMになりすまして悪用されてしまったり、データ提供側に関しても本当に半導体サプライヤとして認定してよいメーカーなのかどうかの精査、開示/非開示の対象となるそもそものOEM/Tier1に対する関所・ルールがないと悪用される機会を生じてしまうことが懸念です。OEM/Tier1の中でも、社内に半導体部門を持っている会社に対する扱いなど、悪用する意図がなくとも出来てしまう環境を構築してしまうことも懸念となります。
- ・データの改定時期で採用などに大きくかわる可能性があるため、変更可能時期は1年のある一定期間などに定めたほうが良いのではないかと（公平性）
- ・サプライヤ側も各品番がどのOEMに採用になっているか、そのモデルがいつまで続く見込などなどの情報をDPFに参画することで得ることができるのであれば有難い
- ・このDPF上での更新で廃番や工場追加などの申請を省くことができるのであれば魅力的
- ・DPF上の登録製品情報の定期更新頻度は任意でしょうか？（資料には3か月と記載あり）
- ・推奨・非推奨情報用途詳細にて、開発中の製品も掲載可能とあります。 開発中の製品について暫定情報も含まれるため登録できるデータに限りがあります。 登録可能なデータのみでも問題ないか？（どこまでデータを入力すればDPFに登録できるでしょうか？） 特にデータシートや前工程・後工程情報等は量産前後に確定します。
- ・先日の説明会にて、当該システムに対する半導体メーカーの必要負担を2ケタ万円/年と伺いました。データ提供者となる半導体メーカーについては、無償乃至は負担額の低減を希望します。
- ・It is good opportunity to build standardized data platform across Japan automotive industries, on the other hand, still each company can decide which supplier's material to choose is part of business decision and this is competitive information for some areas such as EOL, if this activity is responsible for determining the part selection process as an industrial standard, it will be more powerful tool that supplier to pay attention.
- ・今後の進め方についての全体像が分かってよかったと思います。質疑応答の時間をもう少し取ればなお良かったと感じました。半導体メーカーの費用負担はあまり良いアイデアとは思えません。半導体メーカー側としては作業労力が多く、メリットが少ないのではないかとこの見方もあります。
- ・POCで問題として挙げたことを、共有頂けると良かったかと思ひます。POCで妥当と思われる入力項目について教えて頂きたいと考えます。
- ・電話で参加させて頂きました。毎回時間が足りなくなるので初期設定を長くすべきと思ひます。

Agenda

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 前回説明会 (8/27) 振り返り | 13:05 - 13:08 (3分) |
| 2. 車載半導体DPF 運用検討状況 | 13:08 - 13:18 (10分) |
| 3. 車載半導体DPF 開発進捗状況 | 13:18 - 13:31 (13分) |
| 4. 運営費用設定 検討状況 | 13:31 - 13:35 (4分) |

(参考) 委託事業 実施スケジュール (案)

事業外



PoC3に向けて開発進捗問題なし。
半導体



デモシナリオ

以下の業務における のシナリオを用いてデモをさせていただきます。

凡例

→

… 業務の流れ

… データの流れ

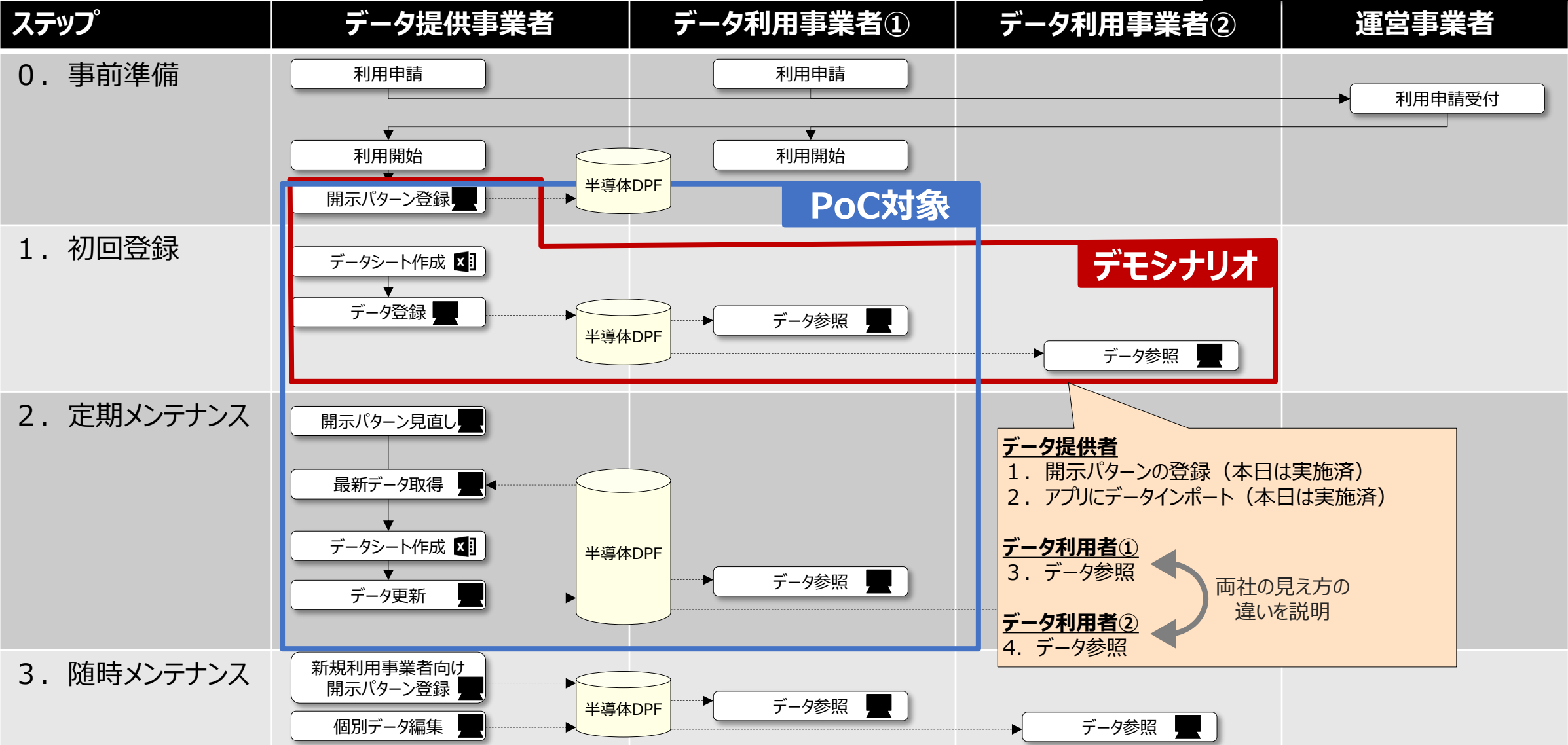
■

… 半導体DPFを用いた業務

📄

… Excelを用いた業務

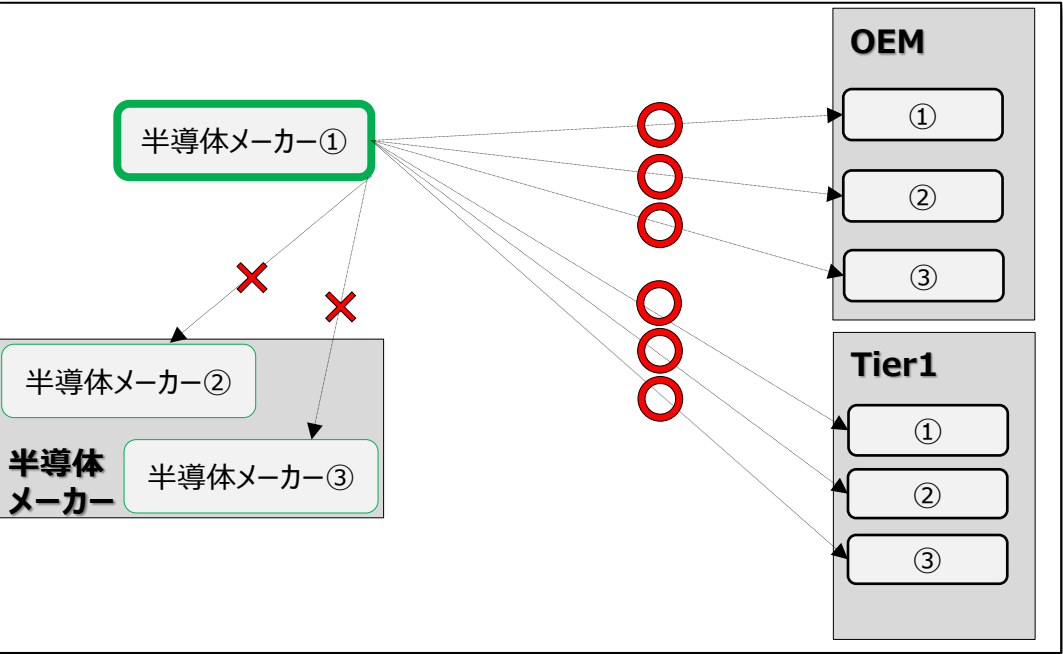
無印

… システム外の業務

開示制御について

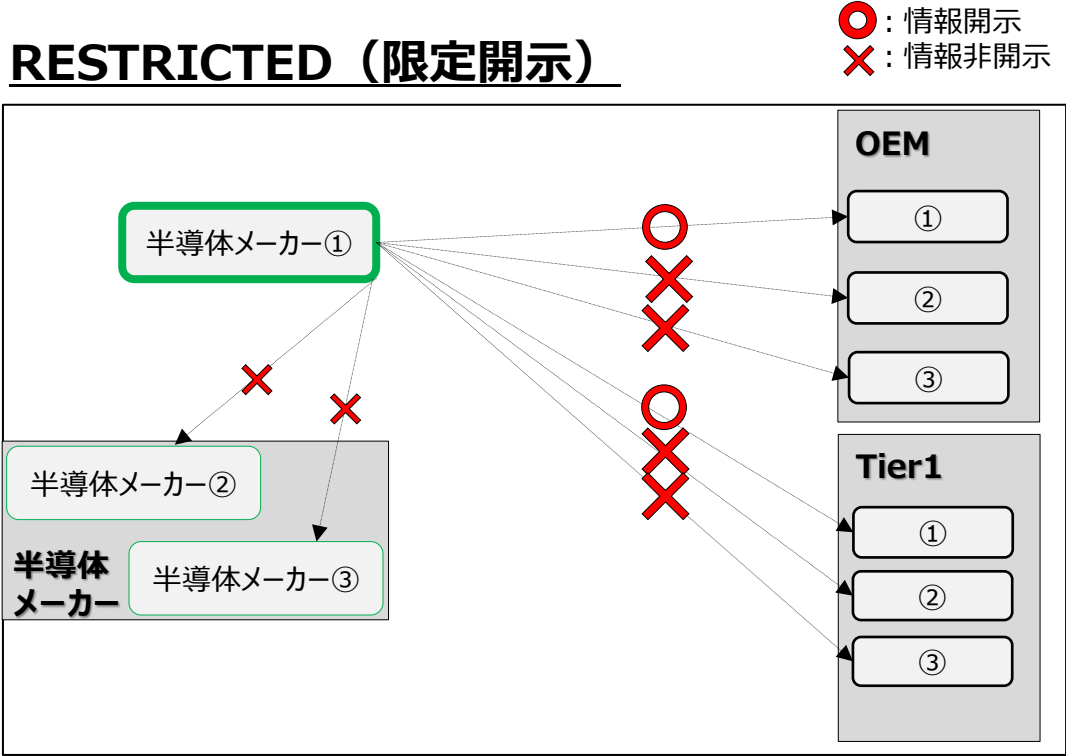
開示設定とは、データ提供事業者のデータ主権に基づき、製品情報を「誰に」「何を」開示するか指定できる機構です。開示区分「ALL（全開示）」、「RESTRICTED（限定開示）」を設け、製品別・開示区分別に開示内容を設定可能とします

ALL（全開示）



✓ アプリ上のデータ利用事業者ユーザは全員閲覧可能

RESTRICTED（限定開示）



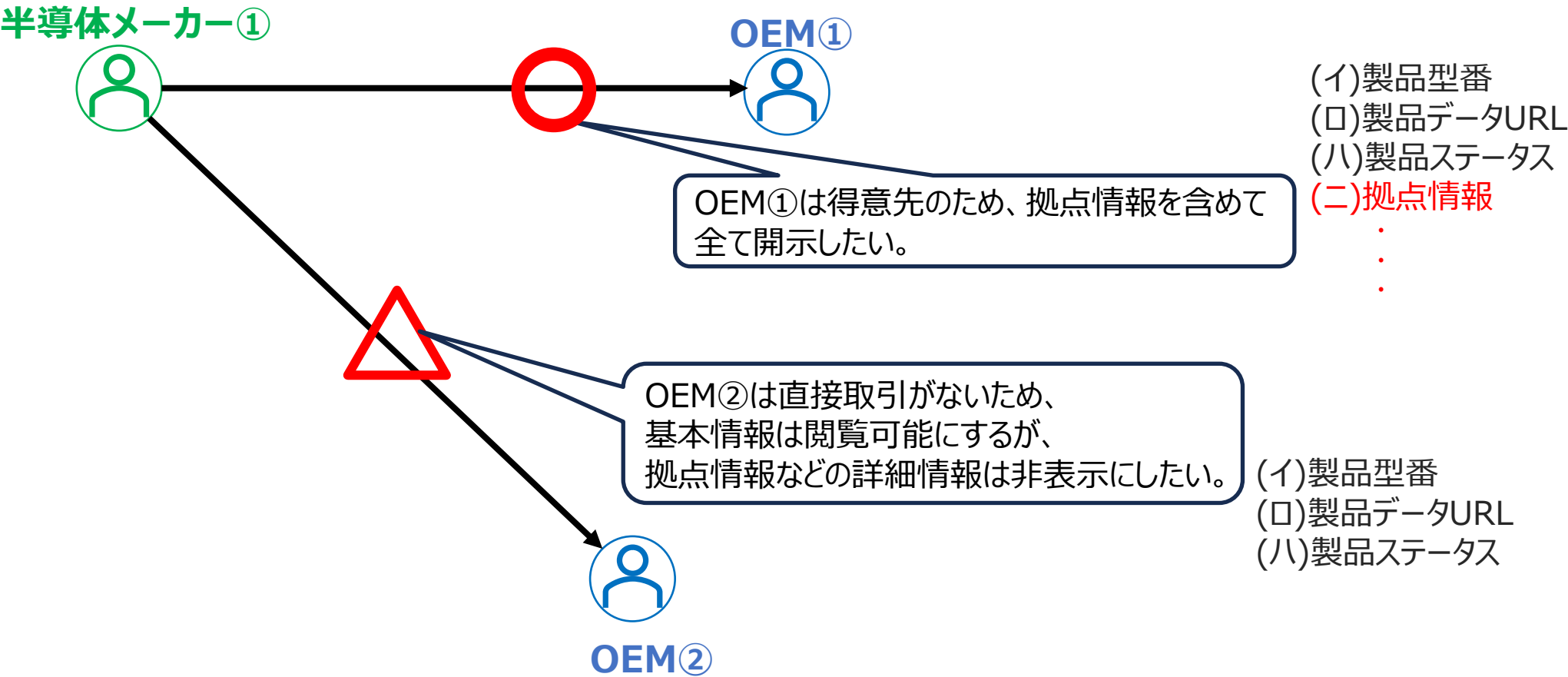
○ : 情報開示
✕ : 情報非開示

✓ データ提供者側が、データ利用者のうち任意のユーザーに対して閲覧権限を設定できる



開示制御_本日デモの想定シチュエーション

開示制御機能によって、特定の取引先にのみ特定の情報を開示する仕組みを説明します。

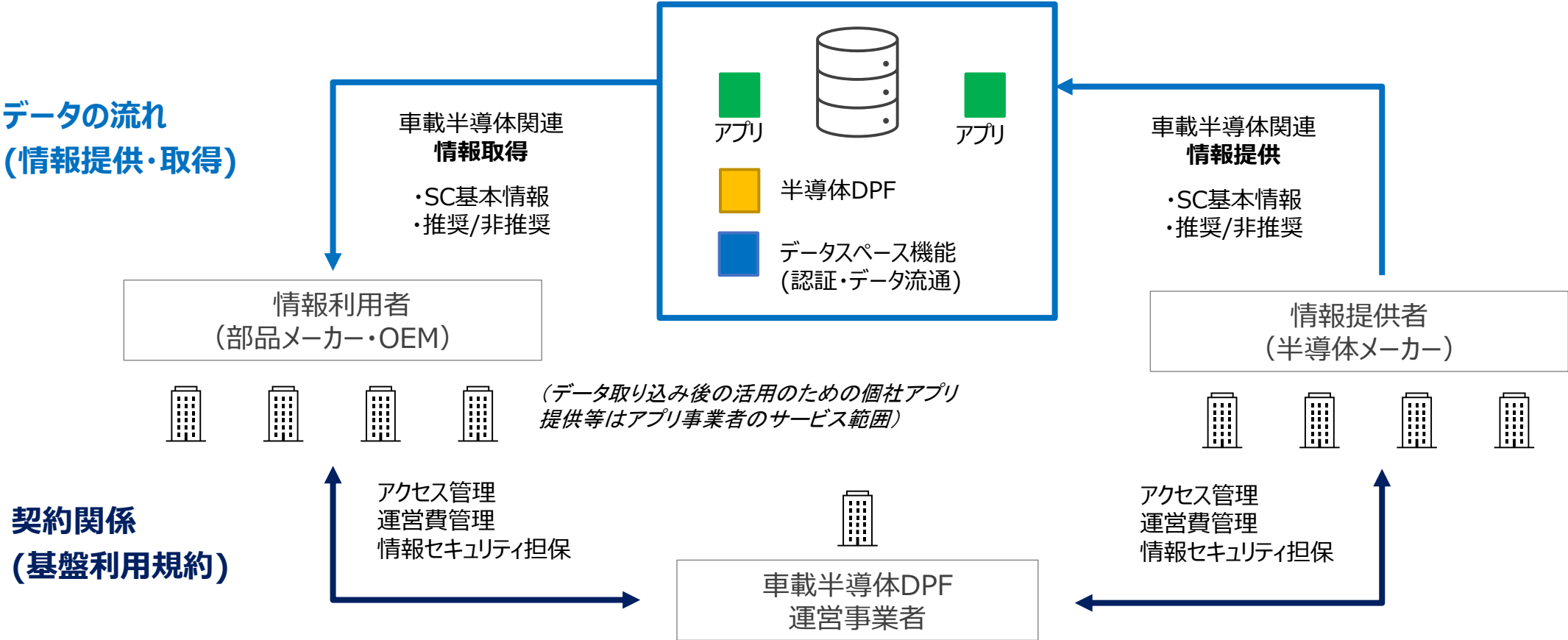


Agenda

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. 前回説明会 (8/27) 振り返り | 13:05 - 13:08 (3分) |
| 2. 車載半導体DPF 運用検討状況 | 13:08 - 13:18 (10分) |
| 3. 車載半導体DPF 開発進捗状況 | 13:18 - 13:31 (13分) |
| 4. 運営費用設定 検討状況 | 13:31 - 13:35 (4分) |

半導体DPF サービス内容 | 利用のイメージ

- ・ 情報提供者(半導体メーカー)のデータ主権を守りながら、企業間での安全・安心な情報共有を実現する。
- ・ 契約(基盤利用規約)は、基盤への参加者(半導体メーカーと部品メーカー・OEM)とDPF運営事業者との契約とする。
※ウラノス・トレーサビリティ管理システムで経産省が主管し策定したモデル規約*1に準拠している。参加者間の個別契約締結の煩雑さを避ける狙いもある。



*1: 出展 経済産業省 データ連携のためのモデル規約 : https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization.html

2026年度 半導体DPFサービス料金 概要(案)

赤字：検討中

機密/検討中

基本の考え方)
公益デジタルプラットフォーム運営事業者として、中立公平・安全安心の基盤サービスを提供するため、利用者との合意に基づく適正価格で基盤運営をおこないます。

基本料金

考え方：法人運営や事務局費用を**参加者全員で負担***1
対象：本サービスを利用する**全ユーザー***2
課金方式：**年度一括・先払い***3

料金表：

自動車OEM	300～1,100万円	*4
部品メーカー/半導体メーカー		
	35万円	売上5000億円以上
	15万円	売上1000億円以上5000億円未満
	5万円	売上1000億円未満



データ利用料

考え方：システム構築・運用費用を**受益者が負担**
対象：本サービスのデータを活用するユーザー
課金方式：**年度一括・先払い***3

料金表：

自動車OEM	120～480万円/年
部品メーカー	120～480万円/年

*1 基本料金について、電池CFPトレサビ管理システム契約ユーザーからの**二重取りはしない**
*2 データ利用者、データ提供者にかかわらず、データ基盤を利用する全ユーザー
データ提供者である半導体メーカーは、DPFの効果が明確になるまでの一定期間は支払不要(データ利用者負担)
*3 年度途中での契約の場合、契約開始月から3月末までの月数で案分した金額をお支払いいただく
例) 10月から利用開始の場合：原則 9月契約・10月支払 (10月～翌3月分を一括で先払い)
*4 利用度合い/メリット等がある指標で考慮した料金傾斜の採用 (参考: 電池CFPのOEMは欧州販売シェアを採用)
OEM基本料については、*1との関係で要調整

基本料金 + データ利用料 (案)

			金額[税抜]	社数(見込)				金額[税抜]	社数(見込)
データ 利用料	システム費用 の充当	(OEM/ 部品メーカー) データ利用者	120～480万円 /年	14社 + xx社	(半導体メーカー) データ提供者			0円/年	xx社
基本料	事務局費用 の充当	OEM	(300～1,100万円/年)					0円 or 5～35万円/年	
		部品メーカー	5～35万円/年						

普及までの一定期間*2前述
はデータ利用者が負担

普及までの一定期間*2前述
はデータ利用者が負担

■CY26 参画者拡大活動スケジュール（案）

対応項目		CY25			CY26											
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
全体	マイルストーン	実現検討段階			実装段階			DPF稼働 提供者		Group1				Group2		
					全体合同説明会			利用者	Group1			Group2		Group3		
					第三者運営団体決定			新規会員募集告知	T) アプリ開発ベンダー認証			T) アプリ開発（各社対応）		T) Step3実施内容告知		
情報提供者	Semicon (PoC_3) Group1	Max 20社	説明会#3		データ登録 (PoC_3)	諸手続き & データ登録最終確認				定期更新				定期更新		
	Semicon (Regular) Group2	TBC						新規会員募集		諸手続き & データ登録						
情報利用者	Tier1 (JAPIA WG) Group1	11社	進め方決定				諸手続き	開示先決定	利用開始							
	Tier1 (JAPIA) Group2	TBC			先行会員募集 (OEM→Tier1)	諸手続き		開示先決定	利用開始							
	Tier1 (Non-JAPIA) Group3	TBC			新規会員募集	諸手続き		開示先決定	利用開始							
	OEM (JAMA WG) Group1	4社			諸手続き	開示先決定	利用開始									
	OEM (JAMA) Group2	10社	事前説明会		諸手続き			開示先決定	利用開始							

データ利用料の低減に向け、参画者拡大活動を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします

依頼事項

自工会/部工会 半導体WG

本日の依頼事項

下記について、Formsアンケートへのご回答をお願いいたします。

項目		内容
1	本日の説明会に関する感想・ご意見	説明内容への理解度、車載半導体データPFへの興味・関心など
2	車載半導体データPFの利用	26年度からのデータPF利用の意思確認
3	データ取得の機能	車載半導体データPFからデータを取得する API(アプリケーションインターフェース)機能の必要性
4	各社の窓口者	車載半導体データPFに関する各社の窓口者(1名/社)
5	ご要望・困りごと	データPFに関する要望・困りごとなど

【質疑応答】

Zoom機能で「**挙手**」、企業名、お名前をご紹介いただき、
ご質問をお願いします。

時間の関係上、すべてのご質問に回答できない場合がありますので、
予めご容赦ください。

ご静聴いただき、ありがとうございました。

本日の説明会に関するアンケートへのご協力をお願いします。
(本Zoom終了後、自動的にMicrosoft Formsが立ち上がります)

【アンケートご協力のお願い】第2回：車
載半導体の安定調達に向けた取り組み
に関する説明会



＜本件に関する問い合わせ＞

【自工会 会員企業】

自工会事務局（井上）までご連絡願います。

【部工会 会員企業】

一般社団法人日本自動車部品工業会 業務部 伊藤、田中、尾関
E-mail : gyoumu@japia.or.jp TEL : 03-3445-4214（業務部）

END